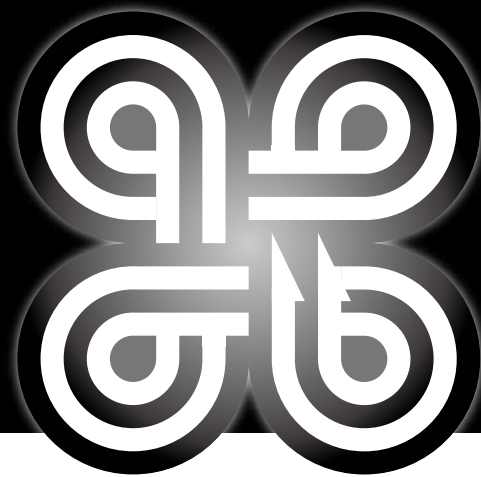


IoT、自動車、ロボット、医療、ウェアブルを具現化する技術の総合展示会

電子機器2018

トータルソリューション展

www.jpccashow.com



のせる つなぐ つくる そして ひろげる

JPCA 2018 Show
第48回国際電子回路産業展
主催：一般社団法人日本電子回路工業会

JIEP 2018
マイクロエレクトロニクスショー
第32回 最先端実装技術・パッケージング展
主催：一般社団法人エレクトロニクス実装学会

JISSO PROTEC 2018
第20回 実装プロセステクノロジー展
主催：一般社団法人日本ロボット工業会



有機デバイス総合展2018
共催：一般社団法人日本電子回路工業会・電子デバイス産業新聞(産業タイムズ社)



WIRE Japan Show 2018

電気・光伝送技術展

共催：一般社団法人日本電子回路工業会・電線新聞((株)工業通信)

Smart Sensing 2018

主催：株式会社JTBコミュニケーションデザイン
共催：一般社団法人日本電子回路工業会

結果報告書

出展者数：516社 小間数：1,476小間 / 来場者数 50,827名

2018 **6.6** WED. ▶ **6.8** FRI. 10:00-17:00

東京ビッグサイト Tokyo Big Sight, Japan

www.jpccashow.com

本部事務局：一般社団法人日本電子回路工業会

〒167-0042 東京都杉並区西荻北 3-12-2 回路会館 2F TEL: 03-5310-2020 FAX: 03-5310-2021 E-mail: show@jpca.org

展示会運営事務局：株式会社 JTB コミュニケーションデザイン

〒105-8335 東京都港区芝 3-23-1 セレスティン芝三井ビルディング TEL: 03-5657-0767 FAX: 03-5657-0645 E-mail: jpcashow@jtbcom.co.jp

ご挨拶

「電子機器トータルソリューション展2018 (JPCA Show / マイクロエレクトロニクスショー / JISSO PROTEC / 有機デバイス総合展 / WIRE Japan Show / Smart Sensing)」は、2018年6月6日(水)～8日(金)の3日間、東京ビッグサイトにて開催され、出展者数516社、出展小間数1,476小間と盛況裡に無事終了することができました。

これもひとえに、ご後援を賜りました経済産業省、IMPACT EXHIBITION MANAGEMENT Co., Ltd.をはじめ、協賛・特別協力団体各位、ご出展いただきました多くの企業の皆様のご支援とご協力の賜物と厚く御礼申し上げます。

次回開催は、2019年6月5日(水)～7日(金)「電子機器トータルソリューション展2019」を予定しておりますので、ご出展・ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

ここに、今回の結果を取りまとめてご報告申し上げますので、ご高覧賜りますようお願い申し上げます。

開催 TOPICS ① : 展示会結果概要

展示会・セミナーともに大盛況!



開催 TOPICS ② : JPCA 賞 (アワード) を展示会場にて実施

JPCA 賞 (アワード) 選考委員会にて、厳正なる審査の上、第14回 JPCA 賞受賞企業が下記の通り決定致しました。

第14回 JPCA 賞

ハロゲンフリー超低伝送損失回路基板材料 R-5515 (銅張積層板)

パナソニック株式会社

当社は、ミリ波帯アンテナ基板に適した「ハロゲンフリー超低伝送損失 基板材料 (品番: R-5515)」を開発した。熱硬化性樹脂でミリ波帯における業界最高の低伝送損失を実現し、アンテナの高効率化・低損失化と基板の加工コスト低減に貢献する。

次世代パッケージ用低熱膨張、低弾性多層化プリプレグ GEA-775G

日立化成株式会社

半導体パッケージの小型化・薄型化・高密度化に伴い、パッケージ基板ではコアを用いずにプリプレグのみで構成されるコアレス構造が注目されているが、コアレス構造では部品実装時に基板の反りが大きくなるといった課題が懸念されている。そこで、パッケージ基板の反り低減が期待できる低熱膨張・低弾性多層化プリプレグ「GEA-775G」を開発した。講演では、開発品の特性、反り評価結果、信頼性評価結果等について報告した。

ファインパターン対応ニッケルフリー新規無電解 Au/Pd/Au 工程の紹介

上村工業株式会社

ファインパターン対応の Ni フリーな無電解 Au/Pd/Au 工程を新規に開発した。優れたパターン性、ワイヤボンディング接合信頼性とはんだ接合信頼性を兼ね備えた皮膜特性結果と新規製品の紹介を行った。



開催 TOPICS ③：開会式・ウェルカムレセプション

開会式

●日 時：6月6日(水) 9:40～10:00

●会 場：東京ビッグサイト 東7・8ホール リンクスペース

御来賓	成田 達治	経済産業省 商務情報政策局 情報産業	課長
開催挨拶	小林 俊文	一般社団法人日本電子回路工業会	会長
	山本 治彦	一般社団法人日本電子回路工業会	副会長
	益 一哉	一般社団法人エレクトロニクス実装学会	会長
	橋本 康彦	一般社団法人日本ロボット工業会	会長
	泉谷 涉	株式会社産業タイムズ社	代表取締役社長
	井上 政基	株式会社工業通信	代表取締役社長
	細野 顕宏	株式会社JTBコミュニケーションデザイン	代表取締役社長
	Won-Ki Nam	世界電子回路業界団体協議会 (WECC)	事務総長
	You Lei	中国電子回路行業協会 (CPCA)	会長
	Michael Weinhold	欧州電子回路協会 (EIPC)	テクニカル ディレクター
	Yogesh G. Adalatwale	インド電子工業会 (ELCINA)	ディレクター
	Luther Wong	香港線路板協会 (HKPCA)	マネージング ディレクター
	John W. Mitchell	米国電子回路協会 (IPC)	専務理事
	Jung Bong Hong	韓国電子回路産業協会 (KPCA)	会長
	Morrison Liang	台湾電路板協会 (TPCA)	副会長

ウェルカムレセプション

出展企業及び業界関係者 **800**名が参加。御来賓として、西銘 恒三郎経済産業省 経済産業副大臣にご挨拶をいただいた。

●日 時：6月6日(水) 17:30～19:30

●会 場：東京ビッグサイト レセプションホール

開催挨拶	橋本 康彦	一般社団法人日本ロボット工業会	会長
来賓挨拶	西銘 恒三郎	経済産業省	経済産業副大臣
乾杯発声	益 一哉	一般社団法人エレクトロニクス実装学会	会長
中締挨拶	井上 政基	株式会社工業通信	代表取締役社長
乾杯登壇	小林 俊文	一般社団法人日本電子回路工業会	会長
	山下 博樹	一般社団法人日本電子回路工業会	副会長
	山本 治彦	一般社団法人日本電子回路工業会	副会長
	岩城 慶太郎	一般社団法人日本電子回路工業会	副会長
	佐藤 英志	一般社団法人日本電子回路工業会	副会長
	松本 博文	一般社団法人エレクトロニクス実装学会	JIEP展示会運営委員会委員長
	曾我 信之	一般社団法人日本ロボット工業会	副会長 JISSO PROTEC 2018 運営委員会委員長
	濱 学洋	一般社団法人日本ロボット工業会	JISSO PROTEC 2018 運営委員会委員
	太田 裕之	一般社団法人日本ロボット工業会	JISSO PROTEC 2018 運営委員会委員
	杉友 庸一	一般社団法人日本ロボット工業会	JISSO PROTEC 2018 運営委員会 青田 広幸 委員代理
	泉谷 涉	株式会社産業タイムズ社	代表取締役社長
	細野 顕宏	株式会社JTBコミュニケーションデザイン	代表取締役社長
	浜島 雅彦	SEMIジャパン	代表 (特別協力団体代表)

(順不同・敬称略)





(一社)日本電子回路工業会
会長
小林 俊文



展示会運営委員会
委員長
山本 治彦



(一社)エレクトロニクス実装学会
会長
益 一哉



(一社)日本ロボット工業会
会長
橋本 康彦



㈱産業タイムズ社
代表取締役社長
泉谷 渉



㈱工業通信
代表取締役社長
井上 政基



㈱JTBコミュニケーションデザイン
代表取締役社長
細野 顕宏

■ 会 期：2018年6月6日(水)～8日(金)

■ 開催時間：10:00～17:00

■ 会 場：東京ビッグサイト 東4～8ホール

■ 名 称：**JPCA Show 2018 第48回国際電子回路産業展**

主 催：一般社団法人日本電子回路工業会

構成展示会：2018 プリント配線板技術展

2018 半導体パッケージング・部品内蔵技術展

フレキシブルプリント配線板製品出展エリア

2018 機器・半導体受託生産システム展

JISSO PROTEC 2018 第20回実装プロセステクノロジー展

主 催：一般社団法人日本ロボット工業会

WIRE Japan Show 2018 電気・光伝達技術展

共 催：一般社団法人日本電子回路工業会

電線新聞(㈱工業通信)

2018 マイクロエレクトロニクスショー 第32回 最先端実装技術・パッケージング展

主 催：一般社団法人エレクトロニクス実装学会

有機デバイス総合展2018 IoT対応半導体・回路基盤展

共 催：一般社団法人日本電子回路工業会

電子デバイス産業新聞(㈱産業タイムズ社)

Smart Sensing 2018

主 催：株式会社JTBコミュニケーションデザイン

共 催：一般社団法人日本電子回路工業会

■ 後 援：経済産業省、IMPACT EXHIBITION MANAGEMENT Co., Ltd.

■ 特別協力：国立研究開発法人産業技術総合研究所、一般社団法人日本電子デバイス産業協会(NEDIA)、SEMI ジャパン、

■ 海外協力：世界電子回路業界団体協議会(WECC)加盟団体：CPCA(中国電子回路産業協会)、EIPC(欧州電子回路協会)、HKPCA(香港線路板協会)、IPC(米国電子回路協会)、IPCA(印度電子回路工業会)、ELCINA(印度電子工業会)、KPCA(韓国電子回路産業協会)、TPCA(台湾線路板協会)

■ 展示会本部事務局：一般社団法人 日本電子回路工業会

■ 協 賛：映像情報メディア学会、画像センシング技術研究会、画像電子学会、カメラ映像機器工業会、自動車技術会、写真感光材料工業会、情報サービス産業協会、情報処理学会、全国鍍金工業組合連合会、電気安全環境研究所、電気学会、電気機能材料工業会、電気設備学会、電子情報技術産業協会、電子情報通信学会、銅箔工業会、日本アミューズメントマシン協会、日本医療機器工業会、日本医療機器テクノロジー協会、日本印刷産業連合会、日本オーディオ協会、日本音響学会、日本化学工業協会、日本火災報知機工業会、日本金型工業会、日本機械工業連合会、日本金属熱処理工業会、日本計量機器工業連合会、日本検査機器工業会、日本産業機械工業会、日本自動車研究所、日本自動車部品工業会、日本真空学会、日本真空工業会、日本精密測定機器工業会、日本電気協会、日本電気計測器工業会、日本電機工業会、日本電気制御機器工業会、日本電子部品信頼性センター、日本照明工業会、日本電線工業会、日本配線システム工業会、日本半導体製造装置協会、日本表面処理機材工業会、日本ファインセラミックス協会、日本分析化学会、日本分析機器工業会、日本ベアリング工業会、日本遊技関連事業協会、日本溶接協会、光産業技術振興協会、ビジネス機械・情報システム産業協会、表面技術協会、ファインセラミックスセンター、太陽光発電技術研究組合、次世代化学材料評価技術研究組合、技術研究組合光子融合基盤技術研究所、日本材料科学会、情報通信ネットワーク産業協会、コンピュータソフトウェア協会、全国電子部品流通連合会、東京都電気卸商業協同組合

■ 展示会運営事務局：(株)JTBコミュニケーションデザイン

(順不同・敬称略)

出展者サービス

会期中のみならず、会期前後も含めて長期間にわたって出展効果を高めていただくために今年より新たなサービスを追加し、ご好評いただいた。

●【NEW】事前メディア発表会の実施

昨年会場に設けたプレス発表の場を、より多くのプレスに会期前に取材してもらえるよう、今年は事前に5月22日(火)に回路会館で実施。

配布資料として、出展者のプレスリリースを記者全員に配布した。

出席プレス社数：26社、出展者プレスリリース提出数：48企業

●【NEW】プレスルーム設置

東4ホール主催者事務室にプレスルームを設置。5月22日(火)に開催したメディア発表会の発表スライドもモニターに投影。64社79媒体117名のプレスに取材いただいた。

開催期間中も出展者のプレスリリースを平置き資料として配布し、多くの出展者・団体にご活用いただくとともに、ブースへの来場者誘致を含めた、PRの場としてご利用いただいた。



●出展者プレスリリース

展示会公式サイト内のトップページに、気軽にプレスリリースを掲載できるシステムを今年も実施。
ブースへの来場誘致を含めたPRの場としてご活用いただいた。

●展示会特集記事

2万部の発行部数を誇り、業界内での知名度も高い「電子デバイス産業新聞」と連携し、展示会特集を連載。
記事が掲載されることで、効果的に業界内での認知度向上にご活用いただいた。その他、日本経済新聞に特集を掲載。

●出展者 (NPI) プレゼンテーション

NPI専用の会場をご用意。プレゼンテーションを通して新製品、新技術をターゲット層に訴求ができた多くの出展者にご好評をいただいた。

●商談室の設置

会場内に無料の商談室を設置。個室の空間で従来の展示会より密度の高い商談ができたにご好評をいただいた。

●ストックルーム

ブース内とは別に、多目的にご利用いただけるスペースを提供した。

来場者サービス

より多くの来場者にお越しいただくため、以下のサービスを実施し、来場者の増加を達成。

●シャトルバスの運行

来場者の利便性向上のため、りんかい線国際展示場駅⇄東京ビッグサイト(7・8ホール)にて無料シャトルバスを運行し、約5,000名の方にご利用いただいた。

●セミナーの充実

質、量ともに国内最大級のセミナー数を誇り、今年はさらなるセミナー内容の充実を図ったことで、例年以上の動員効果を生み出した。

●福島県、熊本県PRブースの充実

熊本地震、東日本大震災の復興支援を目的として、今年も両県にご支援をいただき、両県ならではの自慢の名産品を販売した。熊本県ブースでは、熊本県の営業部長兼しあわせ部長のくまモンも登場し、会場を盛り上げた。

●実装体験コーナー

実際に部品をはんだ付けて実装し、組み立てて、ロボットキットを完成させるまでの工程を体験できる毎回の人気コーナー。業界団体ならではの企画であり、新人教育にも役立つと来場者の方々にご好評をいただいている。

●インターネット・サービス

各休憩所にFree Wi-Fiのアクセスポイントを設置し、来場者サービスの充実を図った。

●VIPラウンジ

VIP用サービスとして「VIPラウンジ」を展示会場内に設置し、商談率の向上を図った。

●キッチンカー

各休憩所(一部除く)にキッチンカーを設置し、昼食環境の充実を図った。

主催者テーマ展示～基板の新たな可能性を探る～

主催者テーマ展示では、先進技術がより身近に感じられ、生活に変化をもたらすユニークな製品、興味が湧いてくる製品が多数展示され、来場者のみならず出展者の方々からも好評いただける展示となった。本年は、(株)産業タイムズ社の特別協力を得て、「電子デバイス産業新聞」にて特集記事を掲載。

■ 20分で完成する超短納期フィルム回路基板

■ 基板 UKIYOE 北斎 [神奈川沖浪裏]

■ 密着性向上プロセス グリキャップ

■ 曲がる透明ドットマトリックス・ディスプレイ

■ 基板アクセサリ

■ メタルクラフト

■ 超小型・超低消費電力プラットフォーム 「トリリオンノード・エンジン」

■ 培養細胞シート用キャリア材料「ATTRAN アトラン®」

■ 自動車FPC

■ 3D・立体プリント配線板の提案

■ プリント基板材の廃材、端材の活用

■ CAD細工

京写

ケイ・ビー・ディ

四国化成工業

シライ電子工業

太陽インキ製造

太洋工業

トリリオンノード研究会

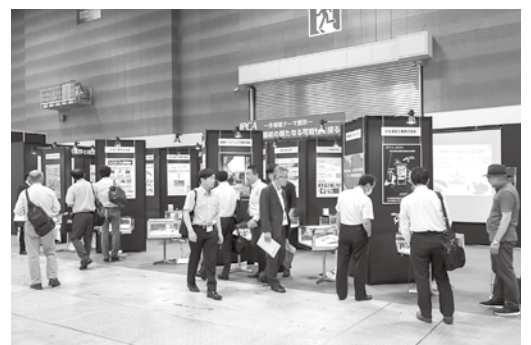
ニッカン工業

日本メクトロン

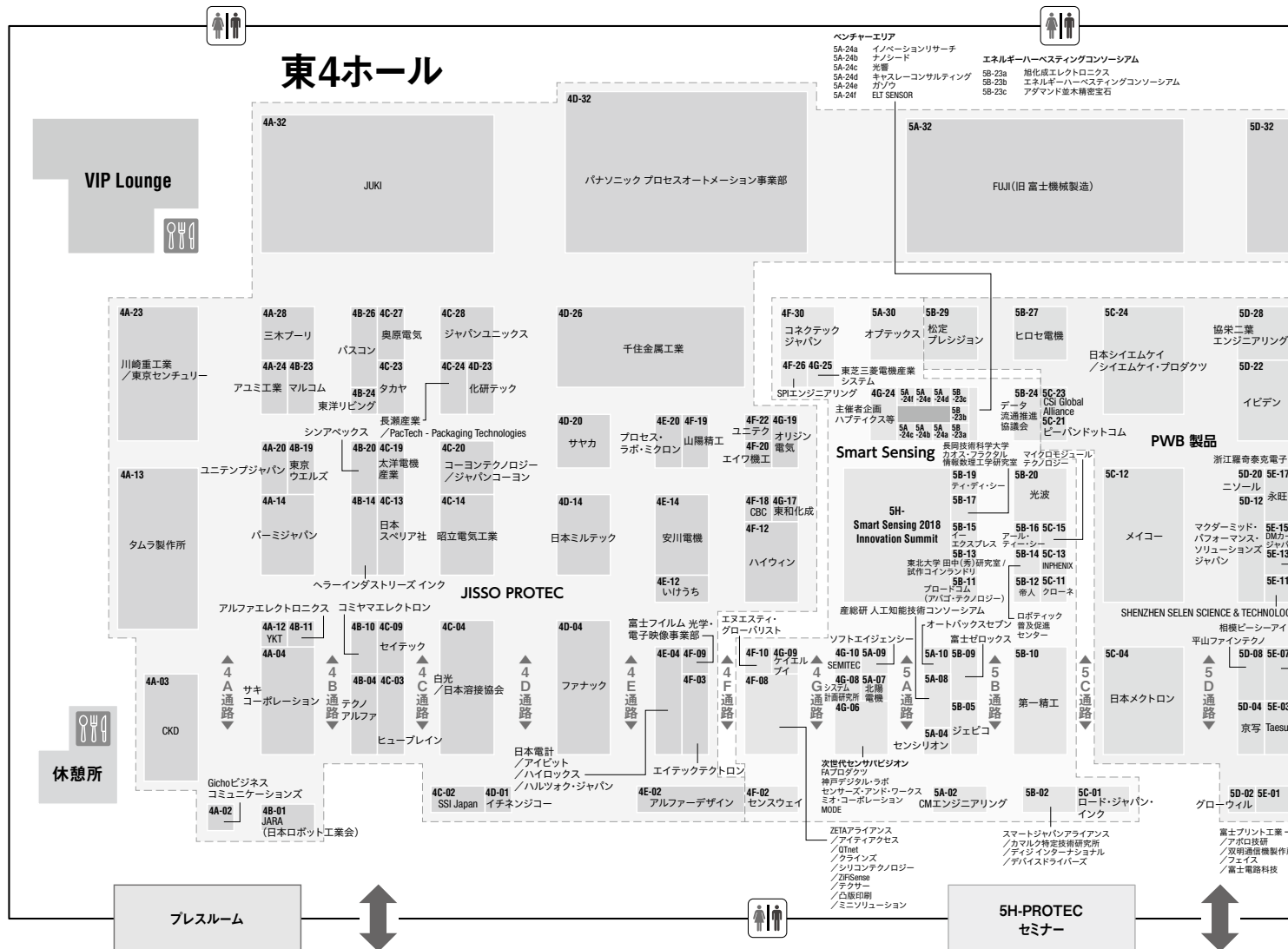
日本シイエムケイ

浜松基板工業

プロセス・ラボ・マイクロ



(順不同・敬称略)

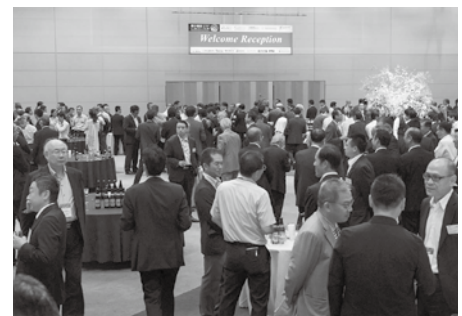
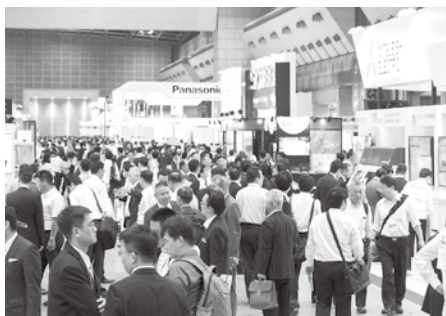
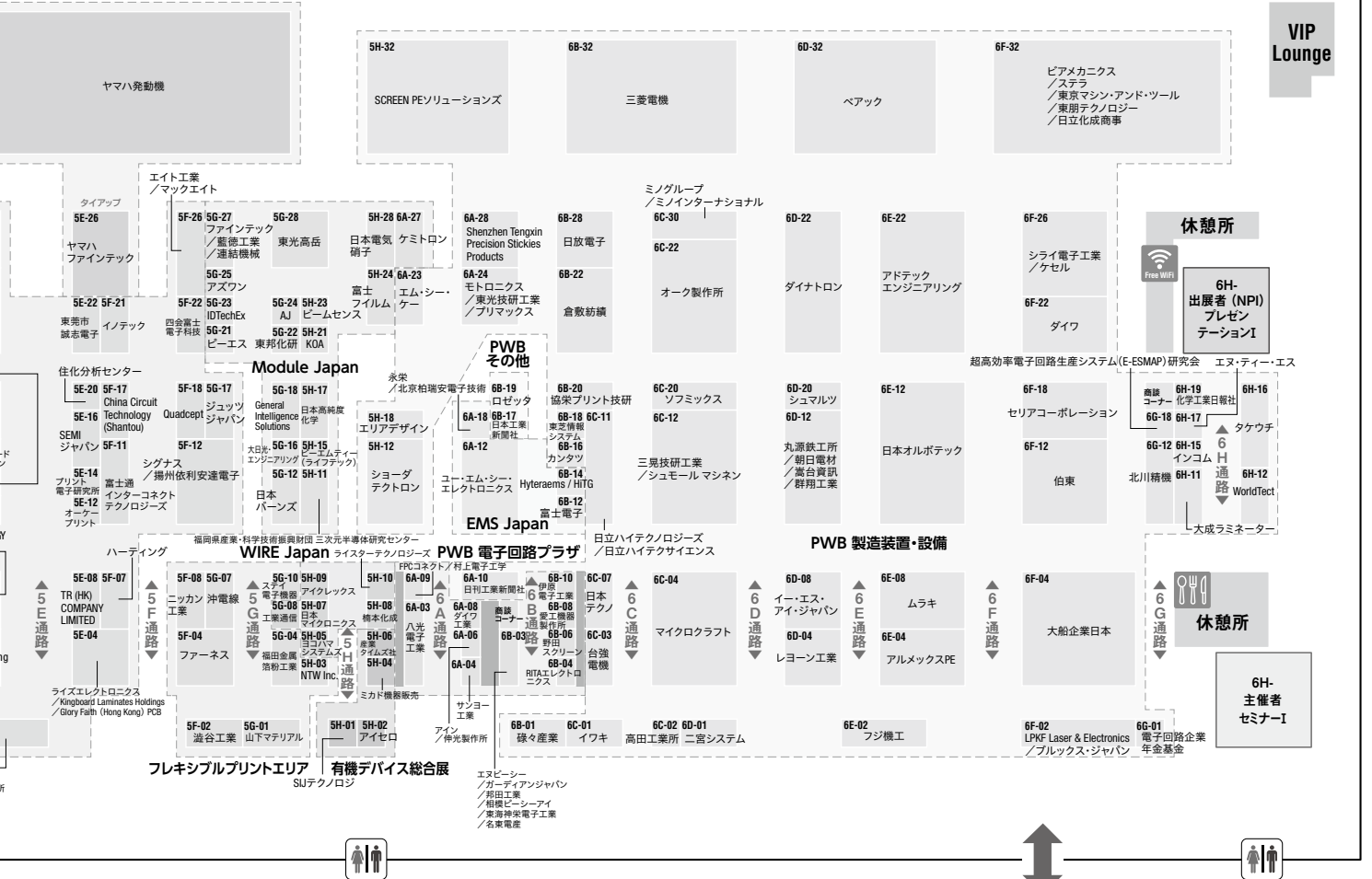




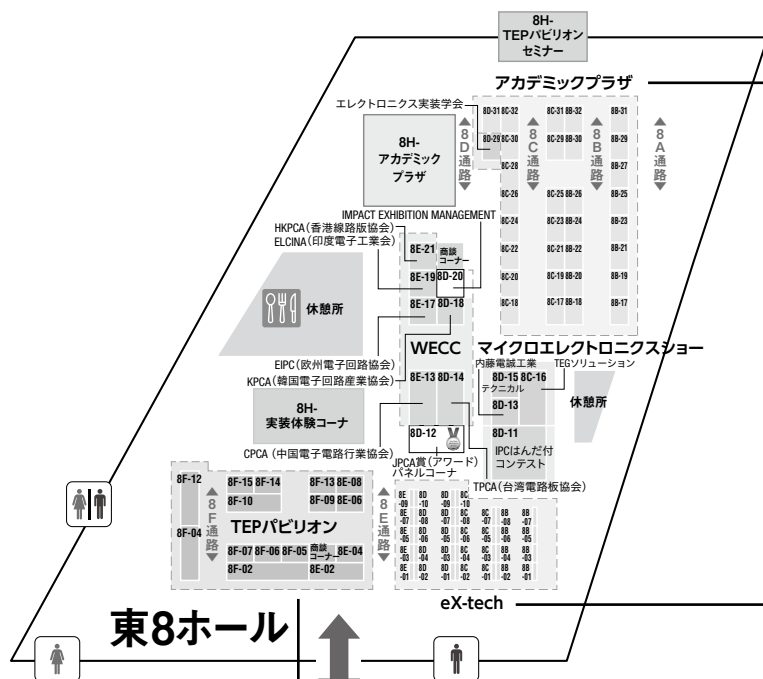
東5ホール

東6ホール

VIP Lounge



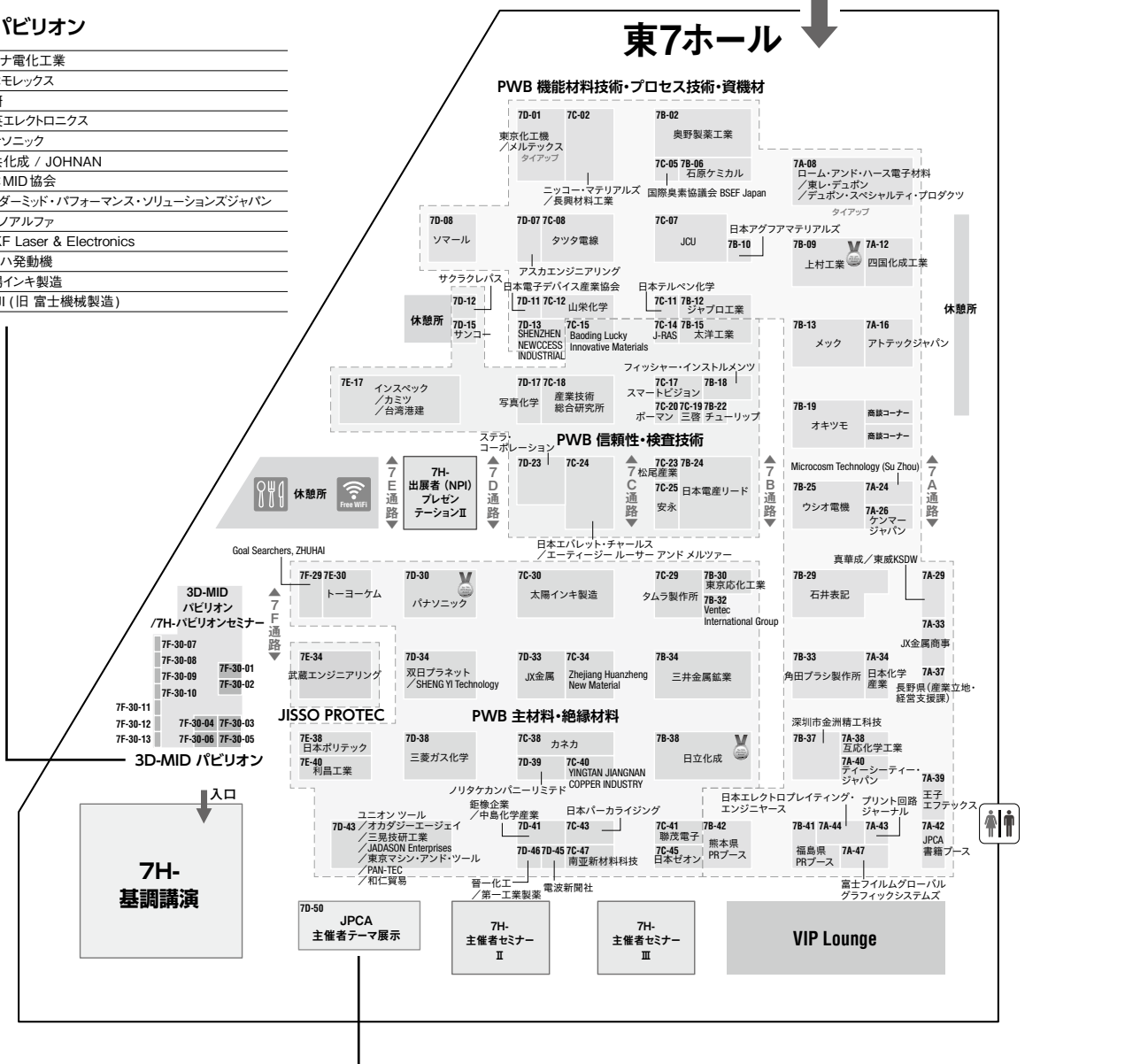
会場レイアウト



3D-MIDパビリオン

- 7F-30-01 エビナ電化工業
- 7F-30-02 日本モレックス
- 7F-30-03 図研
- 7F-30-04 大英エレクトロニクス
- 7F-30-05 パナソニック
- 7F-30-06 三共化成 / JOHNNAN
- 7F-30-07 日本MID協会
- 7F-30-08 マクダーミッド・パフォーマンス・ソリューションズジャパン
- 7F-30-09 テクノアルファ
- 7F-30-10 LPKF Laser & Electronics
- 7F-30-11 ヤマハ発動機
- 7F-30-12 太陽インキ製造
- 7F-30-13 FUJII (旧 富士機械製造)

東7ホール



アカデミックプラザ

8B-17	筑波大学 大学院システム情報工学研究科 安永研究室
8B-18	神戸大学 大学院理学研究科 木村研究室
8B-19	鹿児島大学 理工学研究科機械工学専攻 池田研究室
8B-20	早稲田大学 情報生産システム研究センター 巽研究室
8B-21	鹿児島大学 大学院 理工学研究科 機械工学専攻
8B-22	信州大学 工学部 / シチズンファインデバイス
8B-23	東京都立産業技術研究センター
8B-24	信州大学 工学部
8B-25	山口東京理科大学 工学部機械工学科
8B-26	長野工業高等専門学校 電子制御工学科 / 信州大学 先端磁気デバイス (佐藤・曾根原) 研究室 / スピンデバイステクノロジーセンター
8B-27	大阪産業技術研究所
8B-29	同志社大学 生産システムデザイン研究室
8B-30	明星大学 連携研究センター
8B-31	電磁材料研究所
8B-32	近畿職業能力開発大学校 生産電子情報システム技術科 / トータス

8C-17	電子回路基板技術振興財団
8C-18	東北大学 学際科学フロンティア研究所 島津研究室
8C-19	日本大学 理工学部
8C-20	関東学院大学 大学院工学研究科 小岩研究室 / 沖エンジニアリング
8C-21	群馬大学 大学院理工学府 知能機械創製部門 インテリジェント組込みシステム研究室
8C-22	関東学院大学 理工学部 小岩研究室 / フォトテクニカ
8C-23	群馬大学 大学院理工学府 井上研究室
8C-24	関東学院大学 材料・表面工学研究所
8C-25	群馬工業高等専門学校 材料デザイン研究室
8C-26	東京大学 日暮研究室
8C-28	九州大学 大学院システム生命科学府 ナノ・マイクロ医工学研究室 / 東京大学 実装工学分野研究室 / エクストコム
8C-29	横浜国立大学 / 横浜高度実装技術コンソーシアム
8C-30	九州大学 情報エレクトロニクス部門
8C-31	大阪府立大学 分子認識化学研究グループ / グリーンケム
8C-32	大阪府立大学 大学院工学研究科化学工学分野材料プロセス工学G
8D-31	東京工芸大学 越地研究室

eX-tech

8B-01	いおう化学研究所
8B-02	エスベック
8B-03	Integral Geometry Science
8B-04	トープロテック/サービス
8B-05	大阪有機化学工業
8B-06	AWR Japan
8B-07	東洋紡
8B-08	マニファクチャリングソリューション
8C-01	アンドールシステムサポート
8C-02	愛媛大学
8C-03	図研
8C-04	徳島大学
8C-05	富士設備工業
8C-06	東レエンジニアリング電子機器サービス
8C-07	三菱ケミカル
8C-08	エクスロン・インターナショナル

8C-10	荒川化学工業
8D-01	DIC
8D-02	ウェル プラズマ装置営業部
8D-03	ハニー化成
8D-04	ウェル テストウェハ営業部
8D-05	アテネ
8D-06	岡本工作機械製作所
8D-07	エンブラス半導体機器
8D-08	プラズマイオンアシスト
8D-09	環境レジリエンス
8D-10	ケミトックス
8E-01	富士通クオリティ・ラボ
8E-03	藤倉化成
8E-05	秋田化学工業
8E-07	アキモク鉄工
8E-09	Shimada Appli

TEPパビリオン

8E-02	田中無線電機
8E-04	サトーパーツ
8E-06	花岡無線電機
8E-08	メトロ電気
8F-02	三共社
8F-04	東洋計測器 / メジャーアライアンス
8F-05	日川電機
8F-06	丸三電機
8F-07	セフティデンキ
8F-09	大和無線電機
8F-10	中央無線電機
8F-12	角田無線電機
8F-13	高木システム
8F-14	アール電子
8F-15	ジュバ

主催者テーマ展示

7D-50	京写
	ケイ・ピー・ディ
	四国化成工業
	シライ電子工業
	太陽インキ製造
	太洋工業
	トリオンノード研究会
	ニッカン工業
	日本シイテムケイ
	日本メクトロン
	浜松基板工業
	プロセス・ラボ・ミクロン

スポンサーシップ

約5万人の来場者へ広くアピールいただける様々なスポンサー特典を用意し、ご活用いただいた。

スポンサープログラムの内容

- 東ホールへとつながる「コンコース・動く歩道」に自社広告の看板設置
 - 会場入口に自社パンフレットの平置き
 - 会場フロアマップ広告
 - 展示会メルマガへ社名掲載
 - 公式サイトTOPページへのロゴ掲載
 - 基調講演会場及びレセプション会場でのロゴ掲示
 - VIP招待券の配布 (規定枚数 + 50部追加)
- ※スポンサーのグレードにより特典は異なります。

Platinum Sponsor		
		
Gold Sponsor		
		
		
		
Silver Sponsor		
		
		
Bronze Sponsor		
		
		

JPCA Show 2018

アール電子	8F-14
愛工機器製作所	6B-08
IDTechEx	5G-23
IPC はんだ付コンテスト	8D-11
アイン	6A-06
鉅椽企業	7D-41
朝日電材	6D-12
アスカエンジニアリング	7D-07
アズワン	5G-25
アドテックエンジニアリング	6E-22
アトテックジャパン	7A-16
アポロ技研	5E-01
アルメックスPE	6E-04
イー・エス・アイ・ジャパン	6D-08
石井表記	7B-29
石原ケミカル	7B-06
イノテック	5F-21
伊原電子工業	6B-10
イビデン	5D-22
イワキ	6C-01
インコム	6H-15
インスペック	7E-17
IMPACT EXHIBITION MANAGEMENT	8D-20
上村工業	7B-09
Ventec International Group	7B-32
ウシオ電機	7B-25
永旺	5E-17
AJ	5G-24
HKPCA (香港線路版協会)	8E-21
イト工業	5F-26
EIPC (陝州電子回路協会)	8E-17
エーティージー ルーサー アンド メルツァー	7C-24
エヌ・ディー・エス	6H-17
NTW Inc.	5H-03
エスピーシー	6B-03
エビナ電化工業	7F-30-01
FPCコネク	6A-09
エム・シー・ケー	6A-23
エリアデザイン	5H-18
ELCINA (印度電子工業会)	8E-19
LPKF Laser & Electronics	6F-02
LPKF Laser & Electronics	7F-30-10
王子エフテックス	7A-39
オーク製作所	6C-22
オーケープリント	5E-12
大船企業日本	6F-04
オカダジーエージェイ	7D-43
オキツモ	7B-19
沖電線	5G-07
奥野製薬工業	7B-02
ガーディアンジャパン	6B-03
化学工業日報社	6H-19
角田無線電機	8F-12
カネカ	7C-38
カミツ	7E-17
カンタン	6B-16
北川精機	6G-12
協栄二業エンジニアリング	5D-28
協栄プリント技研	6B-20
京写	5D-04
京写	7D-50
Kingboard Laminates Holdings	5E-04
Quadcept	5F-18
邦田工業	6B-03
熊本県PRブース	7B-42
倉敷紡績	6B-22
群翔工業	6D-12
グローヴル	5D-02
Glory Faith (Hong Kong) PCB	5E-04
ケイ・ピー・ディ	7D-50
KPCA (韓国電子回路産業協会)	8D-18
ケセル	6F-26
ケミロン	6A-27
ケンマージャパン	7A-26
KOA	5H-21
互応化学工業	7A-38
Goal Searchers, ZHUHAI	7F-29
国際臭素協議会 BSEF Japan	7C-05
相模ビーシーアイ	5E-07
相模ビーシーアイ	6B-03
サクラクレバス	7D-12
サトーパーツ	8E-04
山栄化学	7C-12
三共化成	7F-30-06
産業技術総合研究所	7C-18

三共社	8F-02
三啓	7C-19
三晃技研工業	6C-12
三晃技研工業	7D-43
サンコー	7D-15
サンヨー工業	6A-04
CSi Global Alliance	5C-23
シエムケイ・プロダクツ	5C-24
CPCA (中国電子回路産業協会)	8E-13
JX 金属	7D-33
JX 金属商事	7A-33
JCU	7C-07
JPCA 賞 (アワード) パネルコーナ	8D-12
JPCA 書籍ブース	7A-42
J-RAS	7C-14
JADASON Enterprises	7D-43
General Intelligence Solutions	5G-18
SHENG YI Technology	7D-34
深圳市金洲精工科技	7B-37
SHENZHEN SELEN SCIENCE & TECHNOLOGY	5E-11
Shenzhen Tengxin Precision Stickies Products	6A-28
SHENZHEN NEWCESS INDUSTRIAL	7D-13
四会富士電子科技	5F-22
シグナス	5F-12
四国化成工業	7A-12
四国化成工業	7D-50
澁谷工業	5F-02
写真化学	7D-17
ジャプロ工業	7B-12
ジュッツジャパン	5G-17
ジュバ	8F-15
シュマルツ	6D-20
シュモール マシネン	6C-12
ショーダテクトロン	5H-12
JOHNNAN	7F-30-06
スライ電子工業	6F-26
スライ電子工業	7D-50
菅一化工	7D-46
真華成 / 東成 KSDW	7A-29
伸光製作所	6A-06
SCREEN PEソリューションズ	5H-32
図研	7F-30-03
ステイ電子機器	5G-10
ステラ	6F-32
ステラ・コーポレーション	7D-23
スマートビジョン	7C-17
住化分析センター	5E-20
浙江羅奇泰克電子	5E-13
セフティデンキ	8F-07
SEMジャパン	5E-16
セリアコーポレーション	6F-18
双日プラネット	7D-34
双明通信機製作所	5E-01
ソフミックス	6C-20
ソマル	7D-08
嵩台資訊	6D-12
第一工業製薬	7D-46
大英エレクトロニクス	7F-30-04
台強電機	6C-03
大成ラミネーター	6H-11
ダイナロン	6D-22
大日光・エンジニアリング	5G-16
太陽インキ製造	7C-30
太陽インキ製造	7D-50
太陽インキ製造	7F-30-12
太陽工業	7B-15
太陽工業	7D-50
ダイワ	6F-22
ダイワ工業	6A-08
大和無線電機	8F-09
台湾港建	7E-17
Taesung	5E-03
高木システム	8F-13
高田工業所	6C-02
タケウチ	6H-16
タツタ電線	7C-08
田中無線電機	8E-02
タムラ製作所	7C-29
Zhejiang Huanzheng New Material	7C-34
China Circuit Technology (Shantou)	5F-17
中央無線電機	8F-10
チューリップ	7B-22
超高効率電子回路生産システム (E-ESMAP) 研究会	6G-18
長興材料工業	7C-02
角田プリン製作所	7B-33
TR (HK) COMPANY LIMITED	5E-08
DMカードジャパン	5E-15

ティーシーティー・ジャパン	7A-40
TPCA (台湾回路板協会)	8D-14
テクノアルファ	7F-30-09
デュボン・スペシャルティ・プロダクツ	7A-08
電子回路企業年金基金	6G-01
電波新聞社	7D-45
東海神栄電子工業	6B-03
東京応化工業	7B-30
東京化工機	7D-01
東京マシン・アンド・ツール	6F-32
東京マシン・アンド・ツール	7D-43
東光技研工業	6A-24
東光高岳	5G-28
東芝情報システム	6B-18
東邦化研	5G-22
東朋テクノロジー	6F-32
東洋計測器	8F-04
東レ・デュボン	7A-08
トヨーケム	7E-30
トリリオンノード研究会	7D-50
東莞市誠志電子	5E-22
永栄	6A-18
中島化学産業	7D-41
長野県 (産業立地・経営支援課)	7A-37
南亞新材料科技	7C-47
ニソール	5D-20
ニッカン工業	5F-08
ニッカン工業	7D-50
日刊工業新聞社	6A-10
ニッコー・マテリアルズ	7C-02
日放電子	6B-28
日本セオン	7C-45
日本電気硝子	5H-28
日本ポリテック	7E-38
日本メクトロン	5C-04
日本メクトロン	7D-50
二宮システム	6D-01
日本アグフアマテリアルズ	7B-10
日本エバレット・チャールズ	7C-24
日本MID協会	7F-30-07
日本エレクトロプレイング・エンジニアーズ	7A-44
日本オルボテック	6E-12
日本化学産業	7A-34
日本工業新聞社	6B-17
日本高純度化学	5H-17
日本シエムケイ	5C-24
日本シエムケイ	7D-50
日本テクノ	6C-07
日本テルベン化学	7C-11
日本電産リード	7B-24
日本電子デバイス産業協会	7D-11
日本バーカラライジング	7C-43
日本バーンズ	5G-12
日本モレックス	7F-30-02
野田スクリーン	6B-06
ノリタケカンパニーリミテド	7D-39
ハーティング	5F-07
Hyteraems / HITG	6B-14
Baoding Lucky Innovative Materials	7C-15
伯東	6F-12
八光電子工業	6A-03
花岡無線電機	8E-06
パナソニック	7D-30
パナソニック	7F-30-05
浜松基板工業	7D-50
PAN-TEC	7D-43
ピアメカニクス	6F-32
ピーエス	5G-21
ピーエムティー (ライフテック)	5H-15
ピーバンドットコム	5C-21
ピームセンズ	5H-23
日川電機	8F-05
日立化成	7B-38
日立化成商事	6F-32
日立ハイテクサイエンス	6C-11
日立ハイテクロジーズ	6C-11
平山ファインテクノ	5D-08
ヒロセ電機	5B-27
ファーンエス	5F-04
ファインテック	5G-27
和仁貿易	7D-43
フィッシャー・インストルメンツ	7B-18
フェイス	5E-01
福岡県産業・科学技術振興財団 三次元半導体研究センター	5H-11
福島県PRブース	7B-41
福田金属箔粉工業	5G-04
FUJI (旧 富士機械製造)	7F-30-13

フジ機工	6E-02
富士通インターコネクテクトテクノロジーズ	5F-11
富士電子	6B-12
富士回路科技	5E-01
富士フィルム	5H-24
富士フィルムグローバルグラフィックシステムズ	7A-47
富士プリント工業	5E-01
ブリマックス	6A-24
プリント回路ジャーナル	7A-43
プリント電子研究所	5E-14
ブルックス・ジャパン	6F-02
プロセス・ラボ・ミクロン	7D-50
ベアック	6D-32
北京柏瑞安電子技術	6A-18
ポーマン	7C-20
マイクロクラフト	6C-04
Microcosm Technology (Su Zhou)	7A-24
マクダーミッド・パフォーマン・ソリューションズジャパン	5D-12
マクダーミッド・パフォーマン・ソリューションズジャパン	7F-30-08
松尾産業	7C-23
マックエイト	5F-26
松定プレジジョン	5B-29
丸源鉄工所	6D-12
丸三電機	8F-06
三井金属鉱業	7B-34
三菱ガス化学	7D-38
三菱電機	6B-32
ミノインターナショナル	6C-30
ミノグループ	6C-30
村上電子工学	6A-09
ムラキ	6E-08
メイコー	5C-12
名東電産	6B-03
メジャーアライアンス	8F-04
メック	7B-13
メトロ電気	8E-08
メルテックス	7D-01
モトロニクス	6A-24
安永	7C-25
山下マテリアル	5G-01
ヤマハ発動機	7F-30-11
ユー・エム・シー・エレクトロニクス	6A-12
ユニオン ツール	7D-43
揚州依利安達電子	5F-12
ライズエレクトロニクス	5E-04
藍徳工業	5G-27
聯茂電子	7C-41
利昌工業	7E-40
RITAエレクトロニクス	6B-04
YINGTAN JIANGNAN COPPER INDUSTRY	7C-40
レヨン工業	6D-04
連結機械	5G-27
ローム・アンド・ハース電子材料	7A-08
碌々産業	6B-01
ロゼッタ	6B-19
WorldTect	6H-12

ケミックス	8D-10
神戸大学 大学院理学研究科 木村研究室	8B-18
Shimada Appli	8E-09
信州大学 工学部	8B-24
信州大学 工学部 / シチズンファインデバイス	8B-22
図研	8C-03
筑波大学 大学院システム情報工学研究科 安永研究室	8B-17
DIC	8D-01
TEGソリューション	8C-16
テクニカル	8D-15
電子回路基板技術振興財団	8C-17
電磁材料研究所	8B-31
東京工芸大学 越地研究室	8D-31
東京大学 日暮研究室	8C-26
東京都立産業技術研究センター	8B-23
同志社大学 生産システムデザイン研究室	8B-29
東北大学 学際科学フロンティア研究所 島津研究室	8C-18
東洋紡	8B-07
東レエンジニアリング電子機器サービス	8C-06
トープロテクノサービス	8B-04
徳島大学	8C-04
内藤電誠工業	8D-13
長野工業高等専門学校 電子制御工学科 / 信州大学先端磁気デバイス (佐藤・菅根原) 研究室 / スピンデバイステクノロジーセンター	8B-26
日本大学 理工学部	8C-19
ハニー化成	8D-03
藤倉化成	8E-03
富士設備工業	8C-05
富士通クオリティ・ラボ	8E-01
プラズマイオンアシスト	8D-08
マニファクチャリングソリューション	8B-08
三菱ケミカル	8C-07
明星大学 連携研究センター	8B-30
山口東京理科大学 工学部機械工学科	8B-25
横浜国立大学 / 横浜高度実装技術コンソーシアム	8C-29
早稲田大学 情報生産システム研究センター 巽研究室	8B-20

JISSO PROTEC 2018

アイビト	4E-04
アユミ工業	4A-24
アルファデザイン	4E-02
アルファエレクトロニクス	4B-11
いけうち	4E-12
イチネンジコー	4D-01
イテックテクトロン	4F-03
エイワ機工	4F-20
SSI Japan	4C-02
奥原電気	4C-27
オリジン電気	4G-19
化研テック	4D-23
川崎重工業	4A-23
Gichoビジネスコミュニケーションズ	4A-02
コーヨントクノロジー	4C-20
コミヤマエレクトロニクス	4B-10
サキコーポレーション	4A-04
サヤカ	4D-20
山陽精工	4F-19
CKD	4A-03
CBC	4F-18
ジャパンコーヨン	4C-20
ジャパンユニックス	4C-28
JARA (日本ロボット工業会)	4B-01
JUKI	4A-32
昭立電気工業	4C-14
シンアベックス	4B-20
セイテック	4C-09
千住金属工業	4D-26
太平洋電機産業	4C-19
タカヤ	4C-23
タムラ製作所	4A-13
テクノアルファ	4B-04
東京ウエルズ	4B-19
東京センチュリー	4A-23
東洋リビング	4B-24
東和化成	4G-17
長瀬産業	4C-24
日本スベリア社	4C-13
日本電計	4E-04
日本ミルテック	4D-14
日本溶接協会	4C-04
パーミジャパン	4A-14
ハイウイン	4F-12
ハイロックス	4E-04
PacTech - Packaging Technologies	4C-24
パスコン	4B-26
白光	4C-04
パナソニック プロセスオートメーション事業部	4D-32
ハルツォク・ジャパン	4E-04
ヒューブレイン	4C-03
ファナック	4D-04
FUJI (旧 富士機械製造)	5A-32
富士フィルム 光学・電子映像事業部	4F-09

プロセス・ラボ・ミクロン	4E-20
ヘラーインダストリーズ インク	4B-14
マルコム	4B-23
三木ブリー	4A-28
武蔵エンジニアリング	7E-34
安川電機	4E-14
ヤマハ発動機	5D-32
ヤマハフラインテック	5E-26
ユニテック	4F-22
ユニテンプジャパン	4A-20
YKT	4A-12

有機デバイス総合展 2018

アイゼロ	5H-02
SIJテクノロジー	5H-01
産業タイムズ社	5H-06
ミカド機器販売	5H-04

WIRE Japan Show 2018

アイレックス	5H-09
楠本化成	5H-08
工業通信	5G-08
日本マイクロニクス	5H-07
ヨコハマシステムズ	5H-05
ライスターテクノロジーズ	5H-10

Smart Sensing 2018

アール・ディー・シー	5B-16
アイテック	4F-08
旭化成エレクトロニクス	5B-23a
アダマンド並木精密宝石	5B-23c
イーエクスプレス	5B-15
ELT SENSOR	5A-24f
イノベーションリサーチ	5A-24a
INPHENIX	5C-13
SPIエンジニアリング	4F-26
エヌエスティ・グローバル	4F-10
エネルギーハーベスティングコンソーシアム	5B-23b
FAプロダクト	4G-06
オートボックスセブン	5A-10
オブテックス	5A-30
ガゾウ	5A-24e
カマルク特定技術研究所	5B-02
キャスレーコンサルティング	5A-24d
QNet	4F-08
クラインズ	4F-08
クローネ	5C-11
ケイエルバイ	4G-09
光響	5A-24c
光波	5B-20
神戸デジタル・ラボ	4G-06
コネクテックジャパン	4F-30
産総研 人工知能技術コンソーシアム	5A-08
CMエンジニアリング	5A-02
ジェピコ	5B-05
システム計画研究所	4G-08
シリコンテクノロジー	4F-08
スマートジャパンアライアンス	5B-02
ZiFiSense	4F-08
SEMITEC	4G-10
センサーズ・アンド・ワークス	4G-06
センシオリオン	5A-04
センスウェイ	4F-02
ソフトエイジェンシー	5A-09
第一精工	5B-10
ディジ インターナショナル	5B-02
帝人	5B-12
ティ・ディ・シー	5B-19
データ流通推進協議会	5B-24
テクサー	4F-08
デバイスドライバーズ	5B-02
東芝三菱電機産業システム	4G-25
東北大学 田中 (秀) 研究室 / 試作コインランドリ	5B-13
凸版印刷	4F-08
長岡技術科学大学 カオス・フラクタル情報数理工学研究室	5B-17
ナノシード	5A-24b
富士ゼロックス	5B-09
ブロードコム (アパゴ・テクノロジー)	5B-11
北陽電機	5A-07
マイクロモジュールテクノロジー	5C-15
ミオ・コーポレーション	4G-06
ミノソリューション	4F-08
MODE	4G-06
ロード・ジャパン・インク	5C-01
ロボティック普及促進センター	5B-14

2018 マイクロエレクトロニクスショー

秋田化学工業	8E-05
アキモク鉄工	8E-07
アテネ	8D-05
荒川化学工業	8C-10
アンドールシステムサポート	8C-01
いおう化学研究所	8B-01
Integral Geometry Science	8B-03
ウェル テストウェア営業部	8D-04
ウェル プラズマ装置営業部	8D-02
AWR Japan	8B-06
エクソロン・インターナショナル	8C-08
エスベック	8B-02
愛媛大学	8C-02
エレクトロニクス実装学会	8D-29
エンプラス半導体機器	8D-07
大阪産業技術研究所	8B-27
大阪府立大学 大学院工学研究科化学工学分野材料プロセス工学 G	8C-32
大阪府立大学 分子認識化学研究グループ / グリーンケム	8C-31
大阪有機化学工業	8B-05
岡本工作機械製作所	8D-06
鹿児島大学 大学院 理工学研究科 機械工学専攻	8B-21
鹿児島大学 理工学研究科 機械工学専攻 池田研究室	8B-19
環境レジリエンス	8D-09
関東学院大学 材料・表面工学研究所	8C-24
関東学院大学 大学院工学研究科 小岩研究室 / 沖エンジニアリング	8C-20
関東学院大学 理工学部 小岩研究室 / フォトテクニカ	8C-22
九州大学 情報エレクトロニクス部門	8C-30
九州大学 大学院システム生命科学府 ナノ・マイクロ医工学研究室 / 東京大学 実装工学分野研究室 / エクストコム	8C-28
近畿職業能力開発大学校 生産電子情報システム技術科 / トータス	8B-32
群馬工業高等専門学校 材料デザイン研究室	8C-25
群馬大学 大学院理工学府 井上研究室	8C-23
群馬大学 大学院理工学府 知能機械創製部門	8C-21
インテリジェント組込みシステム研究室	



基調講演

有料

VIP無料

●聴講者数：全16セッション 2,610名(前回実績：2,947名)

6月6日(水)	10:30 11:15	 次世代自動車をもたらす電子デバイスの大インパクト ～センサー、メモリー、パワーデバイス、プリント配線板が爆発的成長 泉谷 渉 (株)産業タイムズ社 代表取締役社長
	11:30 12:15	 ロボットの進化と新たな産業自動化への提案 小川 昌寛 (株)安川電機 執行役員 ロボット事業部長
	13:00 13:45	 パートナーロボットと暮らす社会に向けて～生活支援など人に寄添うロボット開発の取組み～ 杉山 雅則 トヨタ自動車(株) エグゼクティブアドバイザー
	14:00 14:45	 スーパーサイクルは続く 和田木 哲哉 野村證券(株) エクイティ・リサーチ部 マネージング・ディレクター
	15:00 15:45	 AIの具体的開発事例とこれからのIoTとAI技術 井元 剛 (株)9DW 代表取締役
	16:00 16:45	 脳をドライブするハプティクス・テクノロジー ～「未来を体感」DigitalHapticsが実現する次世代型コミュニケーション～ 香田 夏雄 (株)ミライセンス 代表取締役  中村 則雄 (株)ミライセンス 取締役CTO (国研)産業技術総合研究所
6月7日(木)	10:30 11:15	 デンソーの車載向け半導体／センサーの向かうべき将来について 鶴田 真徳 (株)デンソー デバイス事業部 常務役員
	11:30 12:15	 自動運転の最新動向と2030年の自動車産業 池山 智也 (株)矢野経済研究所 インダストリアルテクノロジーユニット 自動車産業グループ 主任研究員
	13:00 13:45	 8K時代のイメージング機器で実現する世界 豊村 浩一 パナソニック(株) アプライアンス社 技術本部 イノベティブ・エンターテインメントDC 部長
	14:00 14:45	 印刷方式有機ELディスプレイ製造の夜明け 石橋 義 (株)JOLED 執行役員 製品技術開発部門長
	15:00 15:45	 フラットパネルディスプレイから見る今後のモバイル機器動向 中根 康夫 みずほ証券(株) グローバル・ヘッド・オブ・テクノロジー・リサーチ兼シニア・アナリスト
6月8日(金)	10:30 11:15	 CPS (IoT) Explosionを支えるソニーのイメージセンサーの進化 上田 康弘 ソニー(株) 執行役員コーポレートエグゼクティブ
	11:30 12:15	 IoT広域網ZETAを利用したスマートシティ構想 朱 強 (株)テクサー 代表取締役
	13:00 13:45	 プリンテッド有機エレクトロニクスの基盤技術と応用展開 時任 静士 山形大学 有機エレクトロニクス研究センター長 卓越研究教授
	14:00 14:45	 機能性材料としての不織布の開発動向と技術的進展 矢井田 修 日本不織布協会 顧問
	15:00 15:45	 成長する半導体産業とFHE (フレキシブル・ハイブリッド・エレクトロニクス) 市場 浜島 雅彦 SEMIジャパン 代表

JIEP 最先端実装技術シンポジウム 有料

●聴講者数：1,593名 (前回実績：1,543名)

6月6日(水)	6A1 進展著しいウェアラブル端末の動向を探る Part 1 座長:小日向 茂		6B1 5G時代のSAW/BAWとIoT商用化 座長:土門 孝彰	
	10:40 11:35	6A1-1 印刷工法によるEテキスタイルを用いた生体信号計測への応用と課題 井上 雅博 群馬大学 大学院理工学府知能機械創製部門 准教授		6B1-1 モバイル通信用弾性波デバイス技術と5Gに向けた取り組み 上田 政則 太陽誘電モバイルテクノロジー(株) 取締役
	11:35 12:30	6A1-2 極薄シリコン/フレキシブル基板/テキスタイル集積化技術 小林 健 (国研)産業技術総合研究所 集積マイクロシステム研究センター 社会実装化センサシステム研究チーム 研究チーム長		6B1-2 すべてはセンシングから始まる ~ IoT適用事例 ~ 長谷部 寛昭 CMエンジニアリング(株) ビジネス企画部 マネージャー
	6A2 進展著しいウェアラブル端末の動向を探る Part 2 座長:本多 進		6B2 IoT/5G, Big Data時代をけん引する次世代対応Solutionの提案 座長:松本 博文	
	13:35 14:30	6A2-1 先進フレキシブル加工技術とウェアラブル機器への応用 國場 將生 FLEXCEED(株) 経営企画部 マーケティング開発部 アソシエイト シニア マネージャー		6B2-1 圧電薄膜デバイスの通信システムへの展開 原 基揚 (国研)情報通信研究機構(NICT) 電磁波研究所 時空標準研究室 主任研究員
	14:30 15:25	6A2-2 ヒアラブル端末の発展状況と近未来の姿を探る 古谷 聡 日本電気(株) デジタルプラットフォーム事業部 シニアエキスパート		6B2-2 Fin Techの最新事情 八木 忠三郎 野村ホールディングス(株) 金融イノベーション推進支援室 室長
15:25 16:20	6A2-3 ウェアラブルハプティクスが拓く触覚インタフェースの近未来 篠田 裕之 東京大学 大学院新領域創成科学研究科 教授		6B2-3 2大スマートフォンメーカーのスマホ最新実装技術 上田 弘孝 セミコンサルト 代表	

6月7日(木)	7A1 いよいよ本格化, IoT/5G時代! Slowing Moore's Lawを支える2.1D~3D実装技術 座長:齊藤 雅之		7B1 IoT時代のパワーデバイスの最新技術と今後の展開 Part 1 座長:渡邊 裕彦	
	9:45 10:40	7A1-1 ヘテロジニアス・インテグレーションを実現するインテルのEmbedded Multi-Die Interconnect Bridge (EMIB) 富田 至洋 インテル(株) 開発製造統括本部 アセンブリ・テスト技術開発部 パッケージングR&Dエンジニア		7B1-1 先端デバイスに求められるパワーモジュールのパッケージング技術 加柴 良裕 大阪大学 大学院工学研究科 特任教授
	10:40 11:35	7A1-2 半導体パッケージへのガラス基板の応用 今城 信彦 旭硝子(株) 電子カンパニー 技術開発本部 開発企画部 部長		7B1-2 低蒸気圧液体中への金属ナノ粒子調製と炭素材料との複合化による電気化学デバイスへの応用 畠山 義清 群馬大学 大学院理工学府分子科学部門 助教
	11:35 12:30	7A1-3 NCFを用いた3D一括ボンディング技術 朝日 昇 東レエンジニアリング(株) 開発部門 商品開発センター グループリーダー 主席技師		7B1-3 パワーデバイスモジュール用高耐熱樹脂の設計と評価 高橋 昭雄 横浜国立大学 リスク共生社会創造センター 客員教授
	7A2 FO-WLP/FO-PLPはIoT/5G時代の本命と成り得るか? 座長:西田 秀行		7B2 IoT時代のパワーデバイスの最新技術と今後の展開 Part 2 座長:和嶋 元世	
	13:35 14:30	7A2-1 FO Packageの最新動向と課題, 本命はWLPかPLPか? それとも部品内蔵技術? 西尾 俊彦 (株)SBRテクノロジー 代表取締役		7B2-1 Si, SiC, GaNパワーデバイスの開発動向と課題 岩室 憲幸 筑波大学 数理物質系 物理工学域 教授
14:30 15:25	7A2-2 次世代Fan-out SiP実現に向けた高密度配線板形成の技術挑戦 森川 泰宏 (株)アルバック グローバル市場・技術戦略室 副参事		7B2-2 パワーデバイス用高放熱高耐熱接着シートの開発 森 貴裕 (株)ADEKA 電子材料開発研究所 実装材料研究室 室長	
15:25 16:20	7A2-3 リンテックのFO-WLP対応材料と装置 田久 真也 リンテック(株) アドバンスマテリアルズ事業部門 企画/マーケティング統括部 調査役		7B2-3 パワー半導体モジュールのパッケージ技術 両角 朗 富士電機(株) 電子デバイス事業本部 開発統括部 パッケージ開発部 SiCモジュール課 主査	

6月8日(金)	8A1 自動運転 座長:大竹 精一郎		8B1 ロボットで復活 ものづくり日本 座長:土門 孝彰	
	9:45 10:40	8A1-1 自動運転の現状とキーテクノロジー 二宮 芳樹 名古屋大学 未来社会創造機構 モビリティ領域 特任教授		8B1-1 「今、求められるロボットとは」 ~人の様に使うロボット 星野 京延 THK(株) 常務執行役員
	10:40 11:35	8A1-2 車載用半導体の技術動向と取り組み 深津 重光 (株)デンソー 半導体デバイス事業部 半導体技術企画室 担当部長		8B1-2 産業ドローン製造メーカー TOKO-UAV の戦い 鳥湯 與明 東光鉄工(株) UAV事業部 取締役シニアマネージャー
	11:35 12:30	8A1-3 世界初バッテリーレスEV走行実証 大平 孝 豊橋技術科学大学 未来ビークルシティリサーチセンター センター長		8B1-3 社会実装に向けたロボット農機-農業のスマート化に資する取組み概況 八谷 満 (国研)農業・食品産業技術総合研究機構 農業技術革新工学研究センター 高度作業支援システム研究領域 領域長
	8A2 電動化・知能化と実装技術 座長:三宅 敏広		8B2 AIと創る未来 座長:白石 洋一	
	13:35 14:30	8A2-1 車の電動化・知能化に向けた実装技術と品質課題 堀井 良和 日産自動車(株) パワートレイン・EV技術開発本部 エキスパートリーダー		8B2-1 Deep LearningだけではないAI全般と実装分野への応用例 安永 守利 筑波大学 大学院 システム情報工学研究科 コンピュータサイエンス専攻 教授
14:30 15:25	8A2-2 車載用高密度実装部品の信頼性解析とばらつき評価 于 強 横浜国立大学 大学院工学研究院 教授		8B2-2 ビッグデータ社会におけるAIの重要性 ~AIは新しい材料を発見できるのか?~ 折井 靖光 長瀬産業(株) NVC室 室長	
15:25 16:20	8A2-3 自動運転や電動化を支える基板はんだの自動検査技術 杉山 俊幸 オムロン(株) 検査システム事業部 経営基幹職		8B2-3 ホンダロボティクス 社会実装へ向けた取組 杉山 謙一郎 (株)本田技術研究所 R&Dセンター-X ロボティクスプロジェクト プロジェクトマネージャー 主任研究員	

出展者セミナー

1) 出展者 (NPI) プレゼンテーション

- 日 時：6月6日(水)～8日(金) ●聴講料：無料
●会場：6H-出展者(NPI)会場I・7H-出展者(NPI)会場II ●聴講者数：1,549名(前回実績：2,204名)

●発表出展会社

(50音順)

アトテックジャパン(株)/アユミ工業(株)/イノテック(株)/上村工業(株)/LPKF Laser&Electronics(株)/オーク製作所/沖電線(株)/奥野製薬工業(株)/
KOA(株)/(株)サキコーポレーション/(株)サクラクレパス/山陽精工(株)/JX金属商事(株)/(株)JCU/(株)ジェビコ/シュマルツ(株)/
(株)SCREEN アドバンスドシステムソリューションズ/(株)SCREEN PEソリューションズ/(株)ステラ・コーポレーション/(株)住化分析センター/(株)セリアエンジニアリング/
千住金属工業(株)/(株)ソフトエージェンシー/ダイナトロン(株)/帝人(株)/(株)ティ・ディ・シー/テクノアルファ(株)/(株)東光高岳/
日本エレクトロプレイング・エンジニアーズ(株)/日本オルボテック(株)/ハーティング(株)/パナソニック(株)/ピーエス(株)/日立化成(株)/ファナック(株)/
ふくおかIST 三次元半導体研究センター/(株)プロセス・ラボ・ミクロン/ユニオン ツール(株)/聯茂電子股份有限公司

2) 3D-MIDパビリオンセミナー

- 日 時：6月6日(水)～8日(金) ●聴講料：無料
●会場：7H-3D-MIDパビリオン ●聴講者数：436名(前回実績：505名)

●3D-MIDセミナー発表出展会社

(50音順)

エピナ電化工業(株)/LPKF Laser&Electronics(株)/三共化成(株)/JOHNAN(株)/(株)図研/大英エレクトロニクス(株)/太陽インキ製造(株)/テクノアルファ(株)/日本MID協会/
日本モレックス合同会社/パナソニック(株)/(株)FUJI(旧富士機械製造(株))/マクダーミッド・パフォーマンス・ソリューションズ・ジャパン(株)

3) PROTECセミナー

- 日 時：6月6日(水)～8日(金) ●聴講料：無料
●会場：5H-PROTEC会場 ●聴講者数：898名(前回実績：1,007名)

JISSO PROTEC 特別講演

6月6日(水)・7日(木) 10:30 - 11:30

実装技術の動向と展開 ～ JEITA 実装技術ロードマップのサマリーから～
パナソニック(株) 生産技術本部 生産技術研究所 材料技術開発部
JEITA Jisso 技術ロードマップ専門委員会 副委員長(兼)WG1 主査/
TF2 リーダ 森 将人

●発表出展会社

(50音順)

JUKIオートメーションシステムズ(株)/千住金属工業(株)/
パナソニックFSエンジニアリング(株)/(株)FUJI(旧富士機械製造(株))
武蔵エンジニアリング(株)/ヤマハ発動機(株)

4) アカデミックプラザ

- 日 時：6月6日(水)～8日(金) ●聴講料：無料
●会場：8H-アカデミックプラザ ●聴講者数：863名(前回実績：772名)

●アカデミックプラザ参加大学・研究機関等一覧

(50音順)

大阪府立大学大学院/岡山大学/鹿児島大学大学院/関東学院大学/北九州環境エレクトロニクス研究所/九州大学大学院/近畿職業能力開発大学校/群馬大学大学院/
神戸大学大学院/(国研)産業技術総合研究所/信州大学スピンドバイステクノロジーセンター/筑波大学大学院/東京工芸大学/東京工芸大学大学院/東京大学/
(地独)東京都立産業技術研究センター/東京理科大学/同志社大学/長野工業高等専門学校/日本大学/明星大学/山口東京理科大学/横浜高度実装技術コンソーシアム/
横浜国立大学/龍谷大学/早稲田大学

5) 2018 アカデミックプラザ受賞式

アカデミックプラザで発表される研究発表論文の中から、JIEP展示会事業委員会・アカデミックプラザWG(白石委員長：群馬大学大学院 理工学府 知能機械創製部門准教授)で優秀な論文内容が選考され、アカデミックプラザ賞受賞者が決定致しました。

■ チップコンデンサ内蔵プリント基板を用いた高信号品質配線	筑波大学大学院 システム情報工学研究科 安永研究室 松岡 駿平/安永 守利
■ ファラデー効果利用型 光プローブ電流センサの開発	信州大学 工学部 電子情報システム工学科 先端磁気デバイス(佐藤・曾根原)研究室 藤城 佑太/塩田 健太/岩見 晃希/山崎 健太/曾根原 誠/佐藤 敏郎 シチズンファインデバイス(株) 宮本 光教/久保 利哉
■ 平滑な金薄膜を用いた大気中でのウェハ常温接合とその応用	東京大学 日暮 栄治/山本 道貴/須賀 唯知
■ ノイズ・熱の協調解析適用によるスイッチング電源回路基板の最適化	近畿職業能力開発大学校 庄林 雅了/東 正登 (株)トータス 高橋 成正
アカデミックプラザ5年連続継続賞	日本大学 理工学部 精密機械工学科 内木場・金子研究室

出展者セミナー

6) [NEW] TEPパビリオンセミナー

- 日 時: 6月6日(水)
- 会 場: 8H-TEPパビリオンセミナー会場
- 聴講料: 無料
- 聴講者数: 54名

●発表出展者
(株)高木システム / 東洋計測器(株)

(50音順)

Smart Sensing 2018 Innovation Summit 無料

●聴講者数: 全18セッション 1,673名

Keynote Speech

6日(水)	SK-1	10:30-11:20	IoT・AI時代のデータデザイン・サービスデザイン	持丸 正明 (国研)産業技術総合研究所 人間情報研究部門 研究部門長
	SK-2	11:40-12:30	「最適なセンサとネットワークで技術とビジネスモデルをつなぐ」オプテックスのIoT展開	上村 透 オプテックス(株) 代表取締役社長
7日(木)	SK-3	10:30-11:20	データ流通で創る未来	杉山 恒司 (一社)データ流通推進協議会 広報担当理事・(株)ウフル 執行役員
	SK-4	11:40-12:30	「金融機関からみたIoTの課題と展望」～米国CES2018とドイツハノーバーメッセ2018の視察を踏まえて～	青木 崇 (株)日本政策投資銀行 産業調査部 課長
8日(金)	SK-5	10:30-11:20	サイバーフィジカルイノベーションに向けての取り組み	本村 陽一 (国研)産業技術総合研究所 人工知能研究センター 首席研究員 確率モデリング研究チーム長
	SK-6	11:40-12:30	バーチャルリアリティとテレインジニアリングが拓く未来	館 暉 東京大学 名誉教授

企業プレゼンテーション

6月6日(水)	SP-1	13:00-13:45	【逐次通訳】ZETA AIoT: Edge AI Over LPWAN	李卓群 ジファイセンス社 本社 CEO
	SP-2	14:00-14:45	超小型 MEMS型 近赤外分光センサモジュールと最新のアプリケーション	ケイエルブイ(株)
	SP-3	15:00-15:45	IoT / AIの前に考えること本当の“かんたん”、“お手軽”とは? ~ジャンクデータはいくら集めても役に立たない~	木本 彰 ロード・ジャパン・インク 営業技術 メカトロシステム 部門長
	SP-4	16:00-16:45	【パネルディスカッション】“センサー×クラウド”~なぜ工場やセンサーデータにクラウドが必要なのか~	上野 聡志 MODE, Inc 日本代表 貴田 義和 (株)FAプロダクツ 代表取締役社長 村岡 正和 (株)神戸デジタル・ラボ 取締役
6月7日(木)	SP-5	13:00-13:45	低温実装を核にした OSRDAサービスで実現するセンシングデバイスの未来	安藤 守 コネクテックジャパン(株) CMO
	SP-6	14:00-14:45	工場やプラント内でのセンサーとIoTデバイスの連携とクラウド管理	立岡 佐到士 (株)ソフトエイジェンシー 代表取締役
	SP-7	15:00-15:45	データ流通を加速するデータ取引市場とは	真野 浩 EverySense, Inc. CEO
	SP-8	16:00-16:45	日本のロボットの2019年問題 ~“ロボット”に引っ張られ過ぎないためのロボティックディスカッション~	小林 賢一 認定NPO法人ロボティック普及促進センター 理事長 / (株)ロボットメディア 代表取締役 山崎 文敬 認定NPO法人ロボティック普及促進センター 副理事長 / (株)イクスリサーチ 代表取締役
6月8日(金)	SP-9	13:00-13:45	エネルギーハーベスティングセミナー	
			エネルギーハーベスティングコンソーシアムの活動とIoTへの取り組み	竹内 敬治 エネルギーハーベスティングコンソーシアム (株)NTTデータ経営研究所 社会・環境戦略コンサルティングユニット シニアマネージャー
			低電圧起動の超低消費電力昇圧ICを用いたEH無線センサーノードシステムのご提案	岩崎 弘文 旭化成エレクトロニクス(株) シリコンソリューション事業部 アナログ&RF事業開発部 課長
			エナジーハーベスティングによる電源レス、電池レス、IoTソリューションへのアプローチ	青柳 智英 アダマンド並木精密宝石(株) 技術統括本部 先進開発一部一課 課長
	SP-10	14:00-14:45	Digi LPWA製品ロードマップとM2M/IoT最新事例	江川 将峰 デイジ インターナショナル(株) リージョナルダイレクタ
SP-11	15:00-15:45	すべてはセンシングから始まる! ~IoTの現場適用から見えてくる未来~	長谷部 寛昭 CMエンジニアリング(株) 未来インフラ創出事業部 統括部長	
SP-12	16:00-16:45	LPWAのLoRaWANを活用したIoT通信プラットフォームのご紹介	神保 雄三 センスウェイ(株) 専務取締役	

標準化セミナー 無料

●聴講者数：48名（前回実績：602名）

7日	10:30-12:00	「熱の伝わり方の基本」セミナー	富山 友行・鈴木 康一 富山県立大学／東京理科大学
----	-------------	-----------------	---------------------------

主催者セミナー 無料

●聴講者数：

ダントツものづくりセミナー	1,049名（前回実績：1,115名）
ぶりんとばんじゅくセミナー	275名（前回実績：307名）
JPCAめっき表面処理セミナー	373名（前回実績：264名）
JPCA設計セミナー	480名（前回実績：108名）
光電子回路実装標準化セミナー	107名
「日本の電子回路産業2018」発行報告会	89名

ダントツものづくりセミナー				
ダントツものづくりセミナー 特別講演				
6月6日(水)	13:00-13:50	トヨタ式現場管理	田中 正知 ものづくり大学名誉教授／元・トヨタ生産調査部部長 (株)Jコスト研究所 代表取締役	
	現場改善イノベーションセッション			
	13:50-14:20	超高効率電子回路生産システム (E-ESMAP) 研究会活動紹介 (現場改善を中心に)	山本 治彦 超高効率電子回路生産システム研究会 JPCA 副会長／E-ESMAP 研究会代表幹事	
	14:20-15:00	中小・中堅電子回路現場のスマートメンテナンス	小林 洋 日本設備学会・スマートメンテナンス研究会主査／日産自動車(株) 車両生産技術本部 プラント・メンテナンスエンジニアリング部 エキスパートリーダー	
	15:00-15:40	IoT導入による生産性向上への取り組み	林 英夫 武州工業(株) 代表取締役	
15:40-16:20	現場改善の実態「生産革新の新しい方向性」	柳田 俊明 JPCAものづくり改善インストラクタ／(株)岩城生産システム研究所 コンサルタント		
ダントツものづくりセミナー 特別講演				
6月7日(木)	13:00-13:50	グローバルものづくりの現状と将来像	新宅 純二郎 東京大学 経済学研究科 教授 ものづくり経営研究センター 研究ディレクター	
	IoTものづくりセッション			
	13:50-14:20	超高効率電子回路生産システム (E-ESMAP) 研究会活動紹介 (IoT/ロボットを中心に)	山本 治彦 超高効率電子回路生産システム研究会 JPCA 副会長／E-ESMAP 研究会代表幹事	
	14:20-15:00	IoT事業創造への更なる挑戦!	佐藤 武史 (株)村田製作所 モジュール事業本部 IoT統括部 IoT事業推進部 部長	
	15:00-15:40	中小・中堅電子回路製造業の自動化、IoT・ロボット導入の考察	小島 史夫 早稲田大学 客員教授／(株)デンソー生産革新センター エグゼクティブアドバイザー工学博士	
15:40-16:20	現場データとものづくり管理会計	柘 紫乃 愛知工業大学 経営学部経営学科 准教授		
ダントツものづくりセミナー 特別講演				
6月8日(金)	13:00-13:50	デジタルトランスフォーメーションによる新たなものづくりプロセス	宮澤 秋彦 富士通アドバンステクノロジー(株) 代表取締役社長	
	ものづくりイノベーションセッション (ロボット他)			
	13:50-14:30	生産性向上にむけた、電子業界へのロボット導入について※	坂東 賢二 川崎重工業(株) ロボットビジネスセンター FAソリューション第二統括部 システム部 部長	
	14:30-15:10	IoT／ロボット活用国内外動向	近野 泰 (株)野村総合研究所 パートナー 主席コンサルタント コンサルティング事業本部	
	15:10-15:50	人協働ロボットCOBOTTA紹介※	丸山 堅一 (株)デンソーウエーブ 営業部 企画室 企画2課	
15:50-16:00	ダントツものづくりセミナー終了にあたり(ご挨拶)	山本 治彦 超高効率電子回路生産システム研究会 JPCA 副会長／E-ESMAP 研究会代表幹事		

ぷりんとはんじゅくセミナー		
6月6日(水)	10:30-12:00	ぷりんと配線板全般について“ぷりんとはんじゅくI”をもとに基礎から解決 Part1 小林 正 小林技術事務所
	13:00-14:30	ぷりんと配線板設計について“ぷりんとはんじゅくII”をもとに基礎から解決 田中 弘文 (株)オンテック
	15:00-16:30	物作りの競争力を強める品質管理 長谷川 堅一 PWBコンサルタント
6月7日(木)	10:30-12:00	ぷりんと配線板全般について“ぷりんとはんじゅくI”をもとに基礎から解決 Part2 小林 正 小林技術事務所
6月8日(金)	10:30-12:00	ぷりんとはんじゅくVをもとに、実装の変遷から半導体パッケージング、電子部品などの電子回路実装について解説 榎場 正男 (株)カヤバオフィス/PWBコンサルタント

JPCA めっき表面処理セミナー		
6月7日(木)	13:00-13:45	プリント基板銅めっきのプリプロセス 工藤 淳司 プラメックス(株) 技術部・部長
	13:45-14:30	ダイレクトAu及びAu/Pdめっきのご紹介 鈴木 隆 栄電子工業(株) 開発室・課長
	14:30-15:15	無電解Ni/Pd/Au(厚付含)生産体制強化 石田 卓也 (株)ヨシミツ理化 技術部・係長
	15:15-16:00	薄板への事業展開 佐藤 正宏 (株)アズマ 技術部・係長

JPCA 設計セミナー		
6月8日(金)	13:00-13:45	DDR4: SSO 解析によるDecapの効果と解析による判断 益子 行雄 DDR4実証実験プロジェクト プロジェクトリーダー
	13:50-14:35	高速伝送用プリント配線板の最新動向 PCI Express Gen4 ~ 56Gbps PAM4対応まで 池田 聡 RITAエレクトロニクス(株) iNARTE 認定EMCエンジニア
	14:40-15:15	不具合基板から学ぶ高速メモリ設計ノウハウ 飯坂 直也 アポロ技研(株) 設計技術部 部長 遠藤 聡 アポロ技研(株) 設計技術部 要素技術推進課 課長
	15:20-16:05	DDR5時代に代表される次世代信号解析の動向 前田 真一 KEI Systems, Inc. 代表

光電子回路実装標準化セミナー		
6月6日(水)	10:00-10:05	委員長挨拶 中野 義昭(代理:高原秀行) JPCA光電子回路標準化推進委員会 委員長
	10:05-10:30	光電子回路実装の国際標準化の状況 伊藤 日出男 (国研)産業技術総合研究所 東北センター 所長代理 IEC/TC91/JWG9 (w/TC86) Convenor
	10:30-11:00	光配線板の開発動向 石榎 崇明 慶応義塾大学 理工学部 物理情報工学科 準教授
	11:00-11:30	光I/Oコア(超小型シリコンフォトリソ型光トランシーバ)の製品化とその応用 蔵田 和彦 アイオーコア(株) CTO
	11:30-12:00	車載高速光通信の開発と標準化 高橋 聡 POFプロモーション 代表

「日本の電子回路産業2018」発行報告会		
6月7日(木)	14:00-15:00	電子回路産業の将来展望について 若栗 範彰 JPCA 参事

共催セミナー / 実装体験コーナー / IPCはんだ付けコンテスト

● マイクロソルダリング技術セミナー ● 聴講者数：406名

マイクロソルダリング技術の最新動向	
6月7日(木)	10:30-11:00 マイクロソルダリング技術教育の重要性と課題 藤本 公三 国立大学法人 大阪大学 大学院 工学研究科 マテリアル生産科学専攻 教授
	11:00-11:30 パワーエレクトロニクスに対応したはんだ材料の展開 水口 大輔 千住金属工業(株) 開発技術部 ハンダテクニカルセンター
	11:30-12:00 回路の信頼性確保第一のフラックス洗浄開発物語 ～無名の中小企業がフラックス洗浄トップ企業になるまでの軌跡～ 堀 薫夫 化研テック(株) 代表取締役社長
	12:00-12:30 ソルダ粉末含有樹脂ペーストの最新研究 福本 信次 国立大学法人 大阪大学 大学院 工学研究科 マテリアル生産科学専攻 准教授

● 半導体・オブ・ザ・イヤー2018

6月6日(水)	14:00-15:00	半導体・オブ・ザ・イヤー2018 受賞製品・技術発表
	15:00-17:00	受賞各社による製品プレゼンテーション
半導体デバイス部門	グランプリ	ザイリンクス FPGA 超えの性能を有する新型プロセッサ「Everest」
	優秀賞	東芝メモリ(株) 96層積層プロセスを用いた第4世代3次元フラッシュメモリ「BiCS FLASH」 エイブリック(株) 電源分圧出力付き 超高効率 降圧型スイッチングレギュレータ S-85S1Pシリーズ
半導体製造装置部門	グランプリ	レーザーテック(株) EUVマスクブランクス欠陥検査/レビュー装置「ABICS E120」
	優秀賞	サムコ(株) Aqua Plasmaクリーナー 株式会社SCREENセミコンダクターソリューションズ フットプリント半減、生産性1.5倍の優れたコストパフォーマンスを実現したウエット洗浄装置
半導体用電子材料部門	グランプリ	住友電気工業(株) 高品質SiCエピタキシャル基板「EpiEra」
	優秀賞	旭硝子(株) 深紫外LED用石英レンズ

● 実装体験コーナー 無料 一部企業無料 ● 体験者数：49名 (前回実績：46名)

来場者がさまざまなキットを使った部品実装やウッドバーニングなどを体験できるコーナーを展開しました。

実施日時：6月6日(水)～8日(金)
11:00～12:30 / 14:00～15:30

以下①～⑤のプログラムのいずれかをお選びいただけます。

① オルゴールごま

ごまを回すとその遠心力により電源スイッチが入り4色の発光ダイオードが点灯！メロディICの音が流れます。

費用 一般：1,000円(税込) 出展企業/JPCA会員：無料

② はんだづけ小町 NEW!

だれでも、楽しく簡単に作ることができる初心者向けキットです。楽しく・かわいくはんだ付け LEDで光るキラキラ小物が作れます!!

費用 一般：1,000円(税込) 出展企業/JPCA・JARA・JIEP会員：無料

③ ウッドバーニング NEW!

電熱ペンを使って木を焦がし、絵や模様を描きます。図案を木に転写して、それを電熱ペンでなぞって描きますので、初めての方でも簡単に作品を作ることができます。

費用 一般：1,000円(税込) 出展企業/JPCA・JARA・JIEP会員：無料

④ 光センサー・おちないロボ 【数量限定：17個】

2つのセンサーで床を探りながら走行するロボットです！落ちそうになって光センサーがすばやく反応してバックし、方向転換する賢いロボットです。

費用 2,000円(税込)

⑤ 光センサー・よけロボ NEW!

障害物を見つけて、よけながら走るロボットです！前方に障害物があると、発光ダイオードから発した光が反射します。その反射した光をセンサーでキャッチし、障害物をよける動作をします。

費用 2,000円(税込)

● IPCはんだ付けコンテスト

★ IPCはんだ付けコンテストの開催

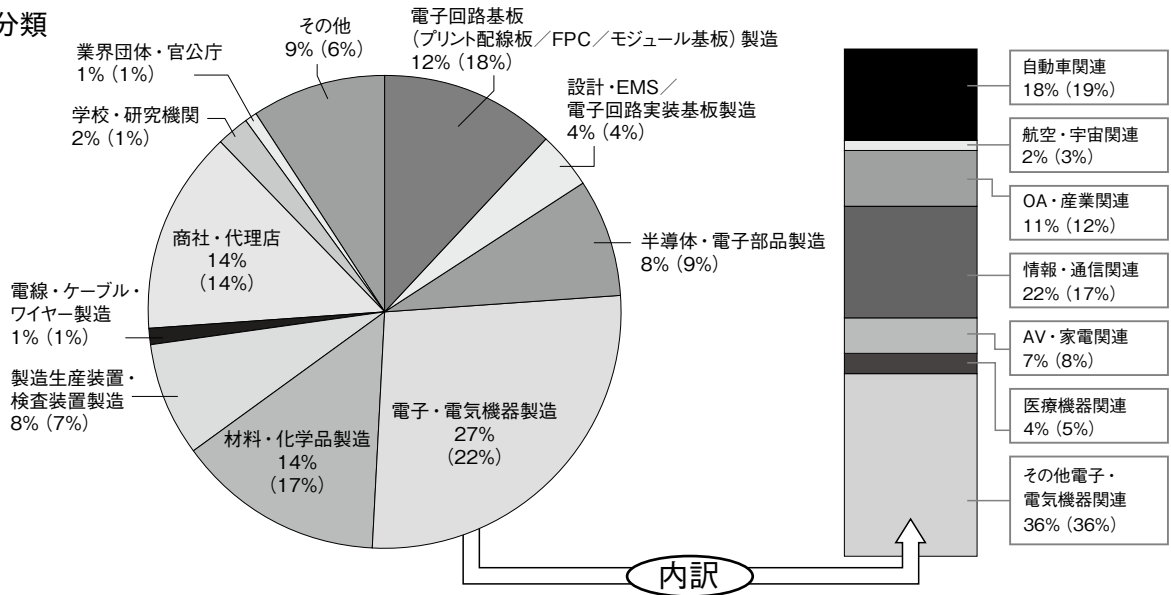
2019年1月アメリカにて開催されるIPC世界はんだ付けコンテストへの出場権をかけた国内予選が会期3日間にわたり開催されました。

制限時間内に、自らの手によりプリント配線板に部品をはんだ付けし、その出来栄を競いました。

全展示会実績

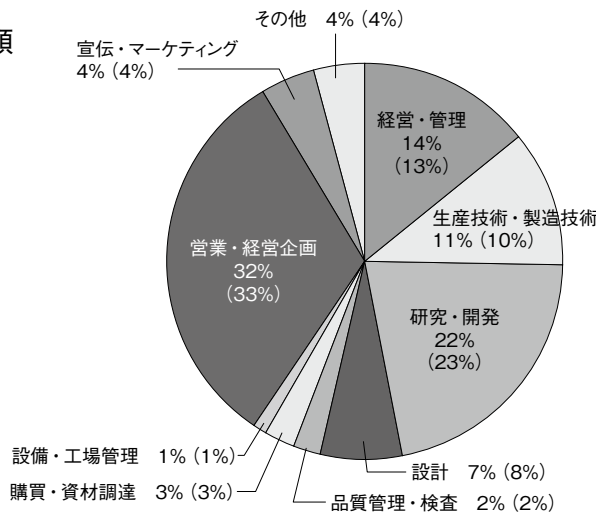
①来場者の業種分類

() 前回数値



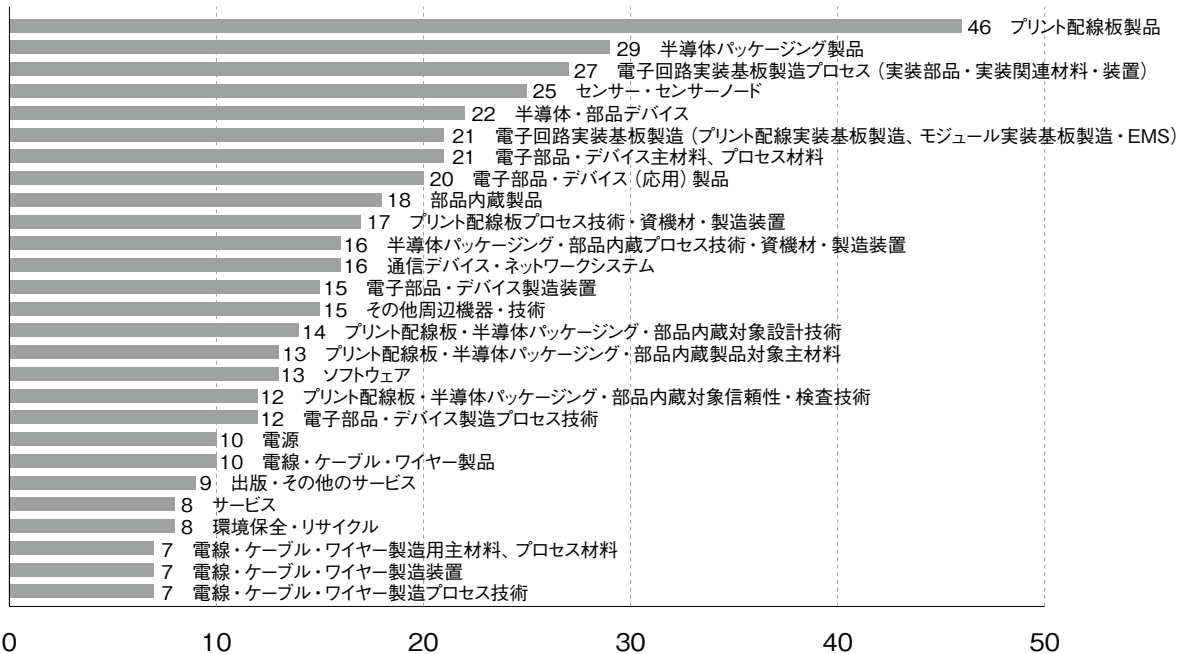
②来場者の職種分類

() 前回数値

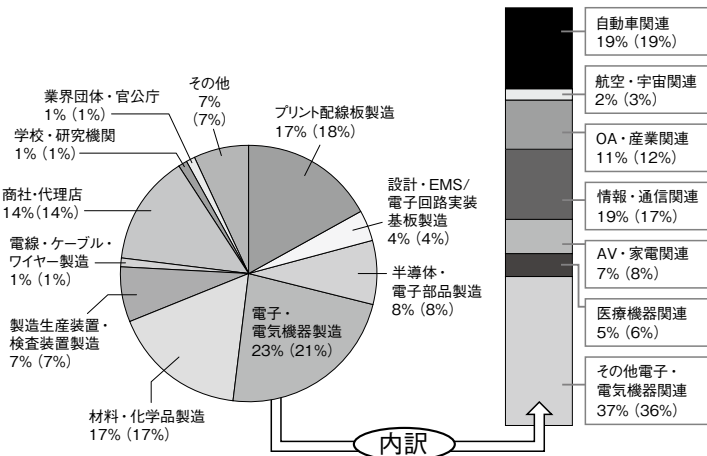


電子機器に関わる幅広い業種の方が来場している。また、経営、製造技術、研究・開発、設計など、ものづくりに関わる来場者が半数を超える。来場者の関心度が高いのはプリント配線板や半導体。今年から Smart Sensing が加わったことで、センサーやセンサーノードに感心のある来場者が増えた。

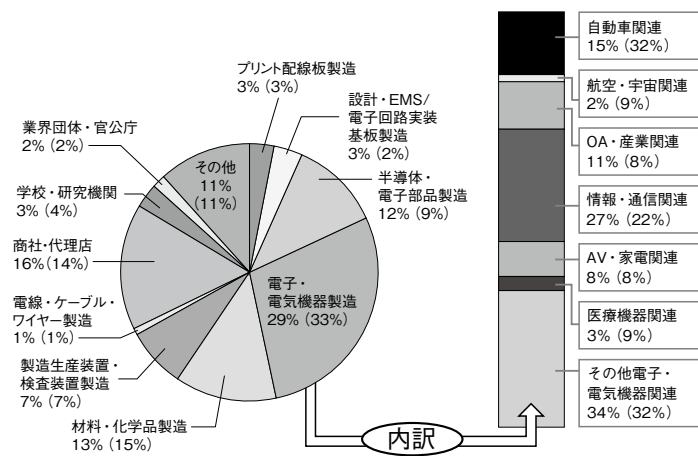
③来場者が関心のある製品分類 ※複数回答



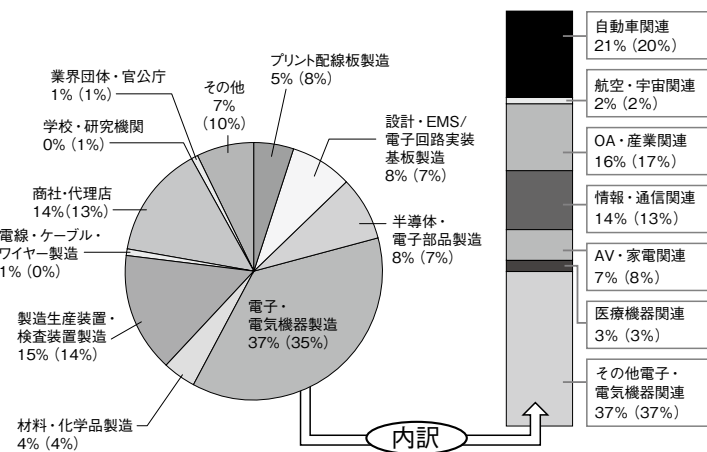
JPCA Show 2018 () 前回数値



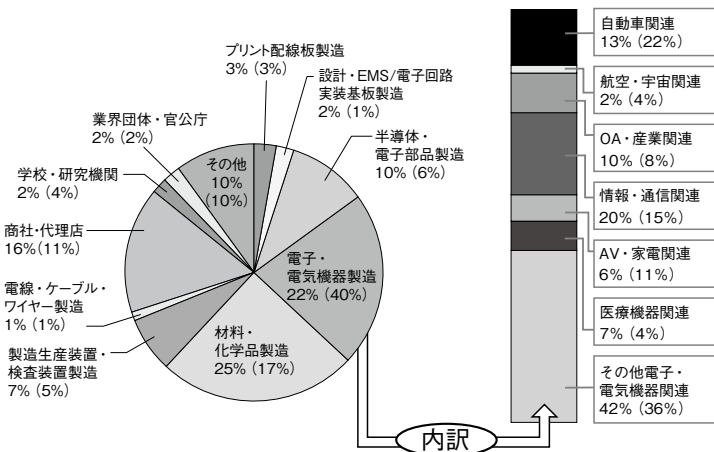
2018 マイクロエレクトロニクスショー () 前回数値



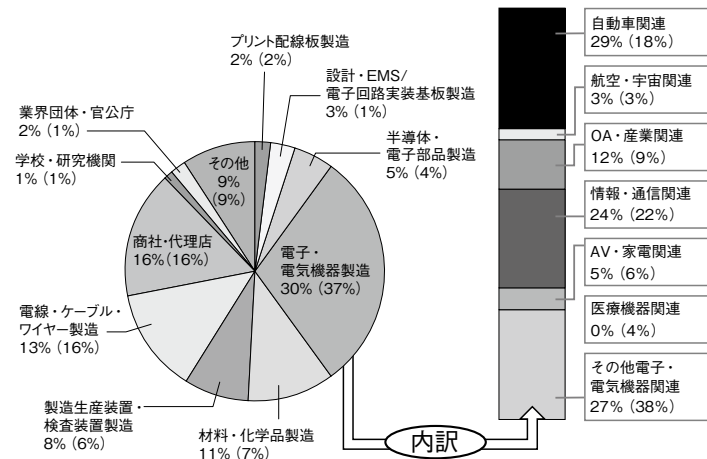
JISSO PROTEC 2018 () 前回数値



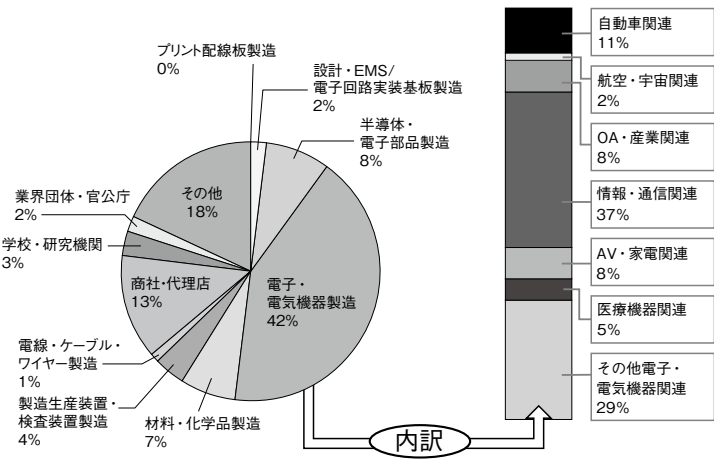
有機デバイス総合展2018 () 前回数値



WIRE Japan Show 2018 () 前回数値

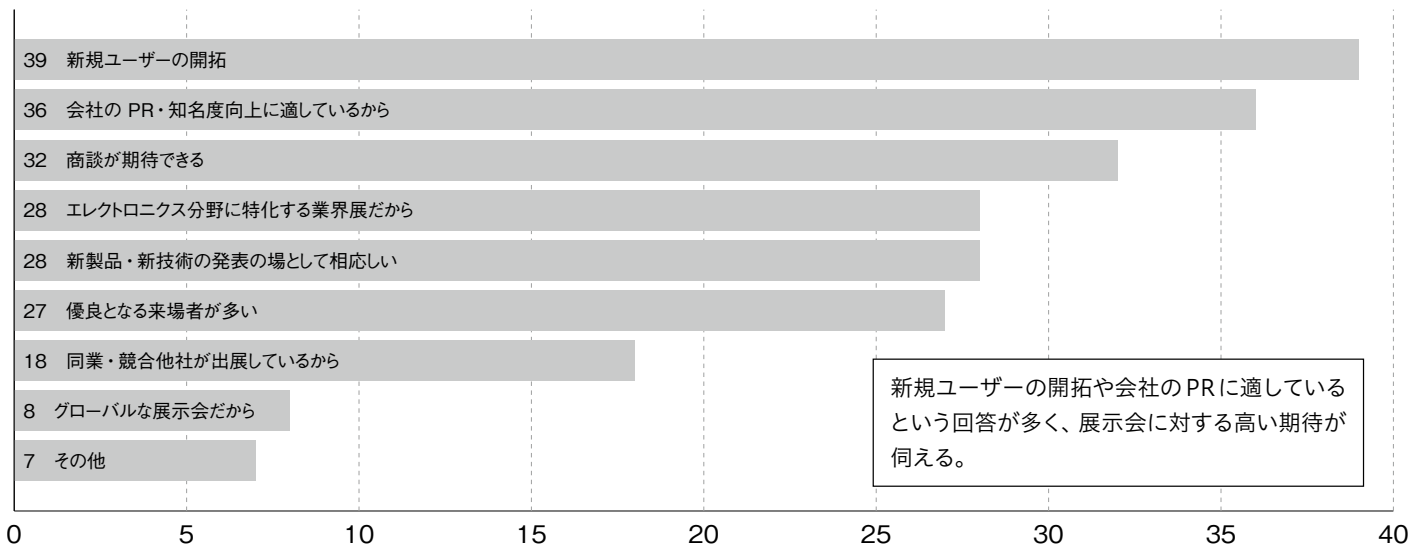


Smart Sensing 2018

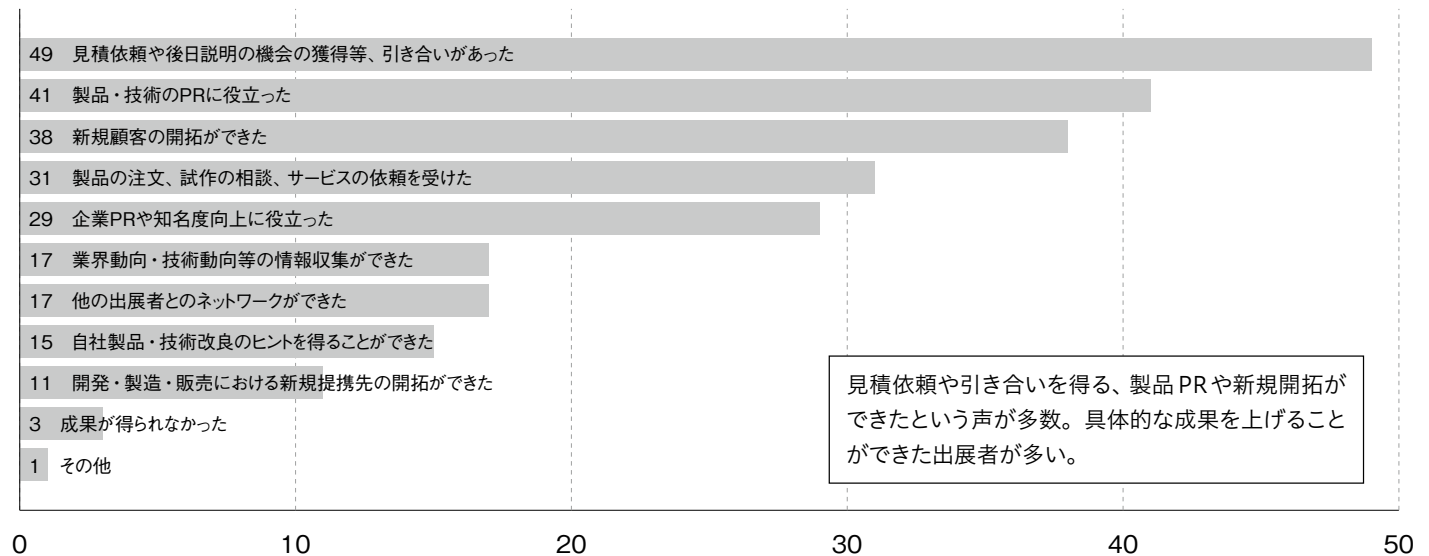


出展者アンケート

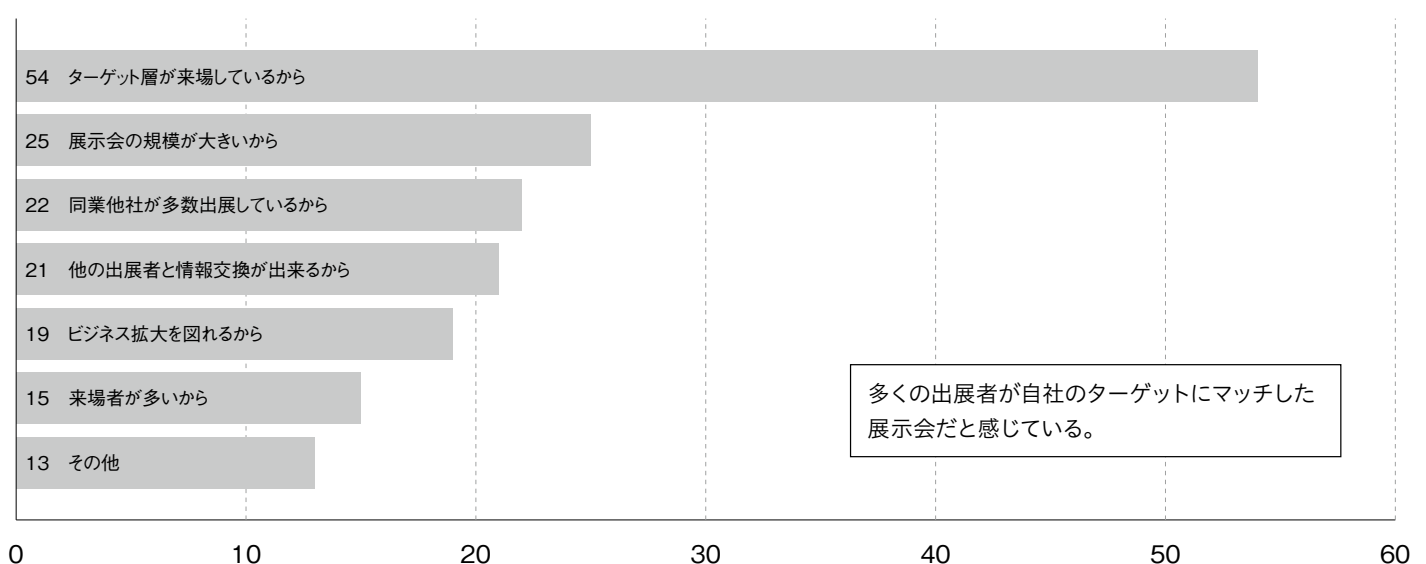
①出展目的 ※複数回答



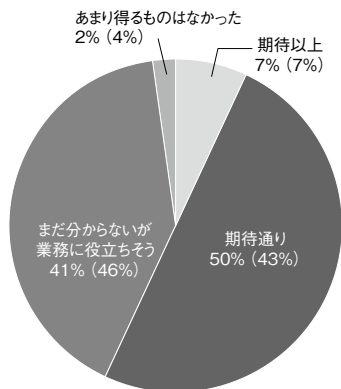
②出展結果 ※複数回答



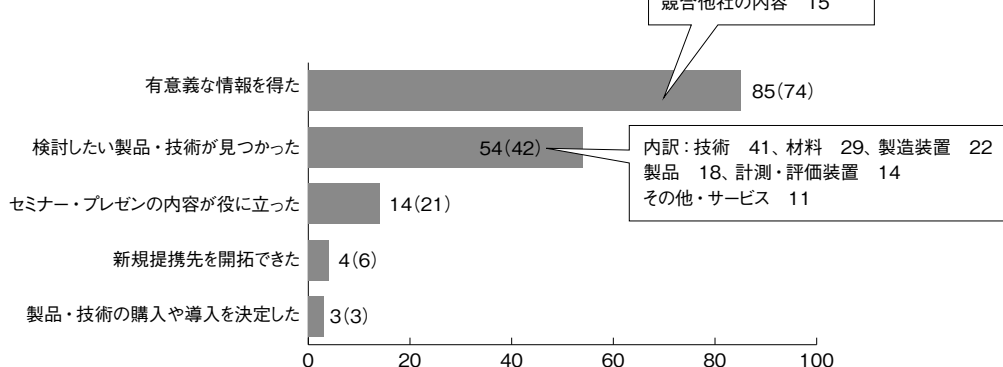
③様々なエレクトロニクス展の中から本展を選んだ理由 ※複数回答



①-1 来場成果

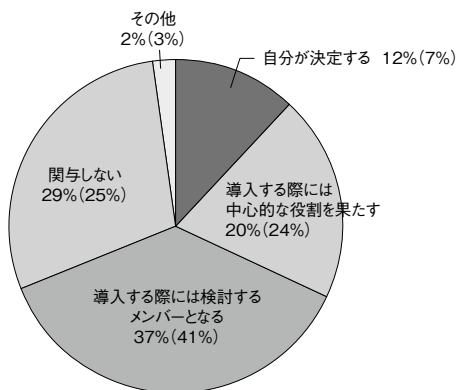


①-2 具体的な成果 ※複数回答



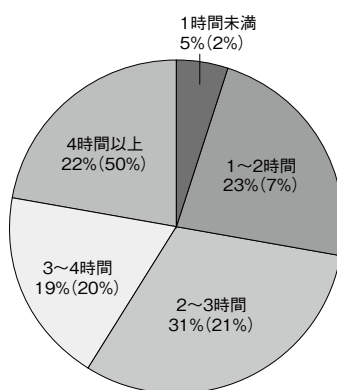
多くの来場者が来場成果を実感し、新製品・技術の情報を得たり検討したい製品・技術を見つけている。

②製品仕込・購入への関与



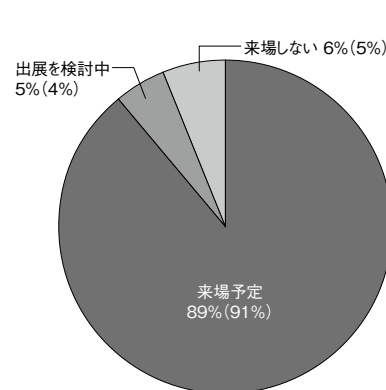
製品の仕入・購入に係る立場にある来場者が多く来場している。

③滞在時間



来場者の多くが時間をかけて展示会場に滞在。また、約9割の来場者が次回の来場を予定しており、来場者の満足度の高さが伺える。

④次回開催の来場予定



広報活動

(1) 関連業界団体との連携強化

メールマガジンの配信や機関誌への広告掲載など相互の展示会においてプロモーション活動を実施。

(2) 広告掲載媒体 (順不同)

インコム/エヌ・ティー・エス/エレクトロニクス実装技術/化学工業日報/JARA 機関誌/新製品情報/SEMI 通信/DMカード/電子デバイス産業新聞/電線新聞/電波新聞/日刊工業新聞/日経産業新聞/日エフォーラム/プリント回路ジャーナル/メカトロニクス/JPCA NEWS

(3) 海外展示会出展・広告掲載実績

2017年 8月 3日(木) ~ 5日(土) インド: IPCA Expo	2018年 2月27日(火) ~ 3月1日(金) 米国: IPC APEX Expo
2017年 9月14日(木) ~ 16日(土) インド: Electronica India	2018年 3月20日(火) ~ 22日(木) 中国: CPCA Show
2017年 10月25日(水) ~ 27日(金) 台湾: TPCA Show	2018年 4月24日(火) ~ 26日(木) 韓国: KPCA Show
2017年 12月 6日(水) ~ 8日(金) 中国: HKPCA & IPC Show	2018年 5月10日(木) ~ 12日(土) タイ: LED & PCB Expo

(4) PRツール製作

国内用招待状 (320,000部)、海外用招待状 (データ配布)、VIP 招待券 (40,000部)、ポスター (1,200枚)、フロアマップ (和英) (80,000枚)、カンファレンスマップ (80,000枚) を作成。

(5) メールマガジンの配信

関連する業界団体やスポンサー企業などの協力により、会期3週間前より毎日メールマガジン配信を実施。来場者数増加につながった。



2018年展示会主催・運営委員会 委員

2018 展示会運営委員会

- 委員長 山本 治彦
(JPCA 副会長／超高効率電子回路生産システム研究会)
- 副委員長 児嶋 一登
(JPCA 理事／(株)京写)
- 中山 明治
(JPCA 理事／日本シイエムケイ(株))
- 委員 松本 博文
(JIEP 展示会運営委員会委員長／日本メクトロン(株))
- 曾我 信之
(JISSO PROTEC 2018 運営委員会委員長／(株)FUJI)
- 泉谷 渉
(有機デバイス総合展 共催会社代表／(株)産業タイムズ社)
- 井上 政基
(WIRE Japan Show 共催会社代表／(株)工業通信)

展示会企画委員会

- 委員長 山本 治彦 (JPCA 副会長)
- 副委員長 ジュリアン・ベিশョア (JPCA 理事／マクダーミッド・パフォーマンス・ソリューションズ・ジャパン(株))
- 古屋 督生 (JPCA 理事／(株)メイコー)
- 委員 猪川 幸司 (日本シイエムケイ(株))
- 泉谷 渉 (株)産業タイムズ社)
- 井上 政基 (株)工業通信)
- 兼子 昌和 (日本メクトロン(株))
- 今井 美津男 (株)FUJI)
- 小岩 一郎 (関東学院大学)
- 後藤 哲朗 (株)ニコン)
- 松本 博文 (日本メクトロン(株))

JPCA 活性化委員会

- 委員長 岩城 慶太郎 (メルテックス(株))
- 副委員長 兼子 昌和 (日本メクトロン(株))
- 委員 高見澤 栄治 (日興運送(株))

JIEP 展示会運営委員会

- 委員長 松本 博文 (日本メクトロン(株))
- 副委員長 栗原 正英 (一般社団法人日本電子回路工業会)
- 副委員長 土門 孝彰 (株)秋田銀行)
- 委員 小日向 茂 (大阪大学)
- 猪川 幸司 (日本シイエムケイ(株))
- 高野 希 (日立化成(株))
- 加藤 義尚 (福岡大学)
- 齊藤 雅之 (株)東芝)
- 西田 秀行 (ニシダエレクトロニクス実装技術支援)
- 宝蔵寺 裕之 (国立研究開発法人産業技術総合研究所)
- 松浦 功治 (三菱電機エンジニアリング(株))
- 松岡 康信 (日本オクラロ(株))
- 本多 進 (C-NET)
- 和嶋 元世 (C-NET)
- 田畑 晴夫 (C-NET)
- 三宅 敏広 (株)デンソー)
- 大竹 精一郎 (株)デンソー)
- 渡邊 裕彦 (富士電機(株))
- 伊藤 寿浩 (東京大学)
- 平田 勝子 (霞テクノロジー)
- 白石 洋一 (群馬大学)
- 小岩 一郎 (関東学院大学)
- 澤田 廉士 (九州大学)
- 内木場 文男 (日本大学)
- 越地 福朗 (東京工芸大学)

JISSO PROTEC 2018 運営委員会

- 委員長 曾我 信之 (株)FUJI)
- 副委員長 富士原 寛 ((一社)日本ロボット工業会)
- 委員 濱 学洋 (JUKI(株))
- 太田 裕之 (ヤマハ発動機(株))
- 青田 広幸 (パナソニック スマートファクトリーソリューションズ(株))

JISSO PROTEC 2018 実行委員会

- 委員長 今井 美津男 (株)FUJI)
- 副委員長 上田 裕司 (JUKIオートメーションシステムズ(株))
- 委員 熊谷 立人 (ヤマハ発動機(株))
- 杉友 庸一 (パナソニック(株))
- 早野 友康 (千住金属工業(株))
- 生島 直俊 (武蔵エンジニアリング(株))
- 榎 寿光 (マイクロニックテクノロジーズ(株))

JISSO PROTEC 2018 企画部会

- 部会長 今井 美津男 (株)FUJI)
- 副部会長 上田 裕司 (JUKIオートメーションシステムズ(株))
- 委員 熊谷 立人 (ヤマハ発動機(株))
- 杉友 庸一 (パナソニック(株))

(順不同・敬称略)

IoT、自動車、ロボット、医療、ウェアラブル等を具現化する技術の総合展示会

電子機器2019 トータルソリューション展

The Total Solution Exhibition for Electronic Equipment 2019

6.5 Wed. ▶ **6.7** Fri.

東京ビッグサイト 西ホール
Tokyo Big Sight, West Halls

JPCA 2019
Show
第49回国際電子回路産業展
主催：一般社団法人日本電子回路工業会

JIEP 2019
マイクロエレクトロニクスショー
第33回 最先端実装技術・パッケージング展
主催：一般社団法人エレクトロニクス実装学会

JISSO
PROTEC 2019
第21回実装プロセステクノロジー展
主催：一般社団法人日本ロボット工業会

有機デバイス総合展 2019
共催：一般社団法人日本電子回路工業会・電子デバイス産業新聞(産業タイムズ社)

W
WIRE Japan Show
2019
電気・光伝送技術展
共催：一般社団法人日本電子回路工業会・電線新聞((株)工業通信)

Smart Sensing
∞ 2019
主催：株式会社JTBコミュニケーションデザイン
共催：一般社団法人日本電子回路工業会

詳細は展示会ウェブサイトへ▶ www.jpccashow.com/

▶ お問い合わせ先 展示会運営事務局：(株)JTBコミュニケーションデザイン
〒105-8335 東京都港区芝3-23-1 セレスティン芝三井ビルディング
TEL: 03-5657-0767 FAX: 03-5657-0645 E-mail: jpcashow@jtbcom.co.jp

本部事務局：
一般社団法人日本電子回路工業会
〒167-0042 東京都杉並区西荻北3-12-2 回路会館2F
TEL: 03-5310-2020 FAX: 03-5310-2021 E-mail: show@jpca.org